

Dell EMC PowerEdge R7525

Guida tecnica

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di **ATTENZIONE** evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un messaggio di **AVVERTENZA** evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

Capitolo 1: Panoramica del prodotto.....	5
Introduzione.....	5
Tecnologie in rilievo.....	5
Capitolo 2: Funzionalità di sistema.....	7
Confronto tra prodotti.....	7
Capitolo 3: Visualizzazioni e funzionalità dello chassis.....	9
Vista anteriore del sistema.....	9
Vista posteriore del sistema.....	11
Componenti interni del sistema.....	12
Quick Resource Locator per sistema PowerEdge R7525.....	14
Capitolo 4: Processore.....	15
Funzioni del processore.....	15
Processori supportati.....	16
Capitolo 5: Memoria.....	18
Memoria supportata.....	18
Velocità della memoria.....	19
Capitolo 6: Storage.....	20
Controller di storage.....	20
Unità supportate.....	20
Unità esterne.....	21
Capitolo 7: Networking e PCIe.....	22
Istruzioni per l'installazione delle schede di espansione.....	22
Capitolo 8: Alimentazione, termica e acustica.....	54
Alimentazione.....	54
Termico.....	55
Acustica.....	55
Capitolo 9: Sistemi operativi supportati.....	57
Capitolo 10: Dell Technologies Services.....	58
Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite.....	58
Dell EMC ProDeploy Plus.....	59
Dell EMC ProDeploy.....	59
Basic Deployment.....	59
Servizi di configurazione dei server Dell EMC.....	59
Servizi di residenza Dell EMC.....	59

Dell EMC Remote Consulting Services.....	59
Dell EMC Data Migration Service.....	59
Dell EMC ProSupport Enterprise Suite.....	59
Dell EMC ProSupport Plus for Enterprise.....	60
Dell EMC ProSupport for Enterprise.....	60
Dell EMC ProSupport One for Data Center.....	61
ProSupport per HPC.....	61
Tecnologie di supporto.....	62
Servizi di formazione Dell Technologies.....	63
Servizi di consulenza Dell Technologies.....	63
Servizi gestiti Dell EMC.....	63
Capitolo 11: OpenManage Systems Management di Dell EMC.....	64
Server e responsabili dello chassis.....	65
Console Dell EMC.....	65
Enabler di automazione.....	65
Integrazione con le console di terze parti.....	65
Connessioni per console di terze parti.....	65
Utilità di aggiornamento Dell EMC.....	65
Risorse di Dell.....	65
Capitolo 12: Appendice A. Specifiche aggiuntive.....	67
Dimensioni dello chassis.....	67
Peso dello chassis.....	68
Specifiche video.....	68
Specifiche delle porte USB.....	69
Specifiche ambientali.....	69
Matrice delle restrizioni termiche.....	71
Capitolo 13: Appendice B. Conformità agli standard.....	77
Capitolo 14: Appendice C, risorse aggiuntive.....	78

Panoramica del prodotto

Argomenti:

- [Introduzione](#)
- [Tecnologie in rilievo](#)

Introduzione

Dell EMC PowerEdge R7525 è un server rack 2U a due socket progettato per l'esecuzione di workload che utilizzano le configurazioni di rete e I/O flessibili. PowerEdge R7525 è dotato dei processori AMD® EPYC™ di seconda e di terza generazione, supporta fino a 32 DIMM, PCI Express (PCIe) slot di espansione Gen 4.0 abilitati e una gamma di tecnologie di interfaccia di rete per coprire le opzioni di rete.

PowerEdge R7525 è pensato per gestire carichi di lavoro e applicazioni complessi, ad esempio data warehouse, e-commerce, database e HPC (High Performance Computing).

Tecnologie in rilievo

La seguente tabella elenca le nuove tecnologie supportate da PowerEdge R7525.

Tabella 1. Nuove tecnologie

Tecnologia	Descrizione dettagliata
Due processori AMD® EPYC™ di seconda e terza generazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia di elaborazione a 7 nm • AMD Interchip global memory interconnect (xGMI) fino a 64 corsie • Fino a 64 core per socket • Fino a 3,8 GHz • TDP massimo: 280 W
3.200 MT/s di memoria DDR4	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 32 DIMM • 8 canali DDR4 per socket, 2 DIMM per canale (2DPC) • Fino a 3.200 MT/s (dipendente dalla configurazione) • Supporta RDIMM, LRDIMM, e 3DS DIMM
PCIe Gen e slot	<ul style="list-style-type: none"> • Gen 4 a 16 T/s
I/O Flex	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda LOM, 2 1G con controller LAN BCM5720 • I/O posteriore con 1 G di porta di gestione rete dedicata • Una porta USB 3.0, una USB 2.0 e VGA • OCP Mezz 3.0 • Opzione porta seriale
CPLD 1-Wire	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto dei dati del payload anteriore di PERC, riser, backplane e I/O posteriore al BIOS e iDRAC.
PERC dedicato	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo di archiviazione anteriore PERC con PERC anteriore 10.4
RAID software	<ul style="list-style-type: none"> • RAID del sistema operativo/PERC S 150
iDRAC9 con Lifecycle Controller	La soluzione Embedded Systems Management per Dell Server è caratterizzata da un inventario hardware e firmware, avvisi approfonditi sulla memoria, prestazioni più rapide, una porta Gb dedicata opzionale e molte altre funzionalità.
Gestione wireless	La funzionalità Quick Sync è un'estensione dell'interfaccia a larghezza di banda ridotta basata su NFC. Quick Sync 2.0 garantisce parità di funzionalità con la versione precedente dell'interfaccia NFC con un'esperienza utente migliorata. Per estendere la funzionalità Quick Sync a una vasta

Tabella 1. Nuove tecnologie (continua)

Tecnologia	Descrizione dettagliata
	gamma di sistemi operativi mobile con una maggiore velocità di throughput dei dati, la versione Quick Sync 2 sostituisce la tecnologia NFC di nuova generazione con la gestione del sistema wireless at-the-box.
Alimentatore	<ul style="list-style-type: none">● La dimensione di 60 mm / 86 mm è il nuovo fattore di forma PSU.● Modalità mista Platinum 800 W CA o HVCC● PSU CC da 1.100 W (-48 V)● Modalità mista Platinum 1.400 W CA o HVCC● Modalità mista Platinum 2.400 W CA o HVCC● CA/HV CC Titanium in modalità mista da 1.100 W
Boot Optimized Storage Subsystem S2 (BOSS S2)	Boot Optimized Storage Subsystem S2 (BOSS S2) è una scheda di soluzione RAID progettata per l'avvio di un sistema operativo server e supporta fino a: <ul style="list-style-type: none">● SSD SATA M.2 da 80 mm● Scheda PCIe con singola interfaccia Gen2 host PCIe x 2● Interfacce dispositivi Dual SATA Gen3
Soluzioni di raffreddamento a liquido	<ul style="list-style-type: none">● La nuova soluzione di raffreddamento a liquido fornisce un metodo efficiente per gestire la temperatura del sistema.● Fornisce inoltre un meccanismo di rilevamento delle perdite di liquido tramite iDRAC. Questa tecnologia è gestita dal meccanismo del sensore di leak del sistema (LLS).● LLS determina perdite di piccole entità di 0,02 ml o grandi come 0,2 ml.

Funzionalità di sistema

Argomenti:

- Confronto tra prodotti

Confronto tra prodotti

Tabella 2. Confronto tra prodotti

Funzione	PowerEdge R7525	PowerEdge R7425
Processore	Due processori AMD® EPYC™ di seconda o di terza generazione.	Due processori AMD Naples™ compatibili con socket SP3
Interconnessione della CPU	Interconnessione di memoria globale tra chip (xGMI-2)	AMD Socket to Socket Global Memory Interface (xGMI)
Memoria	32x DDR4 RDIMM, LRDIMM, 3DS	32x RDIMM, LRDIMM DDR4
Unità disco	3,5 pollici, 2,5 pollici: 12G SAS, 6G SATA, NVMe HDD	3,5 pollici, 2,5 pollici: 12G SAS, 6G SATA, HDD
Controller di storage	H755, H755N, H745, HBA345, HBA355, H345, H840, 12G SAS HBA RAID SW: S150	Adattatori: H330, H730P, H740P, H840, HBA330, 12G SAS HBA RAID SW: S140
SSD PCIe	Fino a 24 SSD PCIe	Fino a 24 SSD PCIe
Slot PCIe	Fino a 8 (PCIe 4.0)	Fino a 8 (Gen3 x16)
rNDC	2 x 1 GB	Determinate schede di rete secondarie: 4 x 1 GB, 4 x 10 GB, 2 x 10 GB + 2 x 1 GB o 2 x 25 GB
OCP	Sì per OCP 3.0	NA
Porte USB	Parte anteriore: 1 USB 2.0, 1 iDRAC USB (micro-AB USB) Parte posteriore: 1 USB 3.0 e 1 USB 2.0 Interno: 1 USB 3.0	Anteriore: 1 USB 2.0, 1 iDRAC USB (micro USB), 1 porta anteriore USB 3.0 opzionale Posteriore: 2 USB 3.0 Interno: 1 USB 3.0
Altezza rack	2U	2U
Alimentatori	Modalità mista (MM) CA/HV CC (Platinum) da 800 W, 1400 W, 2400 W, Titanium 1100 W in modalità mista CA/HV CC, PSU CC da 1.100 W (-48 V)	CA (Platinum): 2400 W, 2000 W, 1600 W, 1100 W, 495 W 750 W CA Platinum: modalità mista HV CC (solo per la Cina), modalità mista CA, CC (CC solo per la Cina) Gold da 1100 W da -48 V CC
Gestione dei sistemi	LC 3.x, OpenManage, QuickSync2.0, OMPC3, Digital License Key, iDRAC Direct (porta micro-USB), Easy Restore	LC 3.x, OpenManage, QuickSync 2.0, Digital License Key, iDRAC9, iDRAC Direct (porta micro-USB dedicata), Easy Restore, vFlash
GPU	3 x 300 W (DW) o 6 x 75 W (SW)	3 x 300 W (DW) o 6 x 150 W (SW)

Tabella 2. Confronto tra prodotti (continua)

Funzione	PowerEdge R7525	PowerEdge R7425
Disponibilità	Unità hot-plug, alimentatori ridondanti hot-plug, BOSS, IDSDM	Unità hot-plug, alimentatori ridondanti hot-plug, BOSS, IDSDM

Visualizzazioni e funzionalità dello chassis

Argomenti:

- Vista anteriore del sistema
- Vista posteriore del sistema
- Componenti interni del sistema
- Quick Resource Locator per sistema PowerEdge R7525

Vista anteriore del sistema

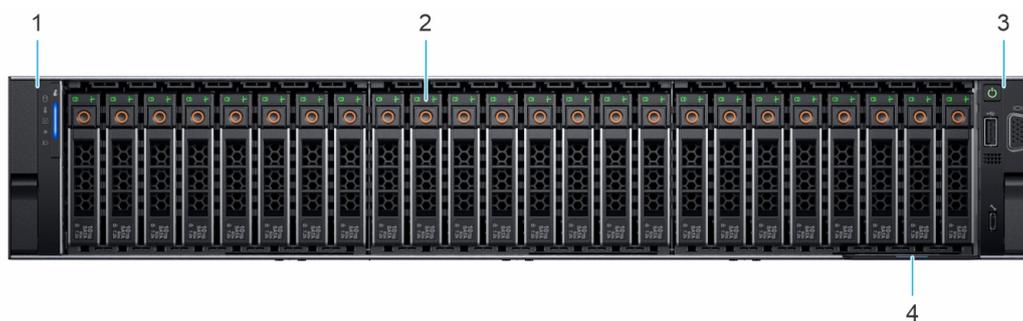


Figura 1. Vista anteriore di un sistema con 24 unità da 2,5 pollici

1. Pannello di controllo sinistro
2. Unità (24)
3. Pannello di controllo destro
4. Etichetta informativa

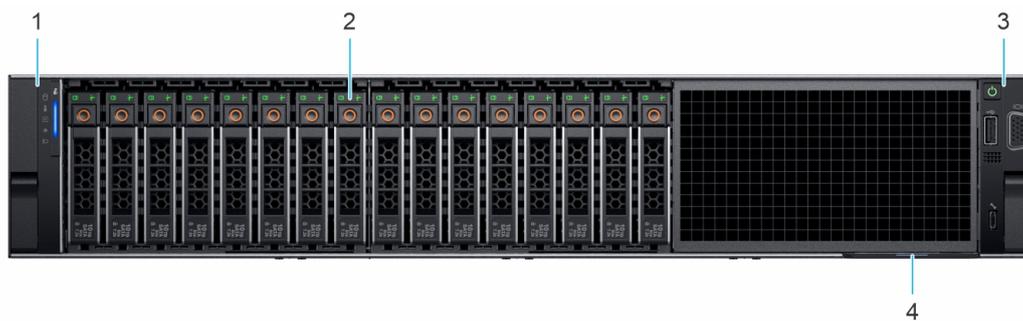


Figura 2. Vista anteriore di un sistema con 16 unità da 2,5 pollici

1. Pannello di controllo sinistro
2. Unità (16)
3. Pannello di controllo destro
4. Etichetta informativa



Figura 3. Vista anteriore di un sistema con 8 unità da 2,5 pollici

1. Pannello di controllo sinistro
2. Unità (8)
3. Pannello di controllo destro
4. Etichetta informativa

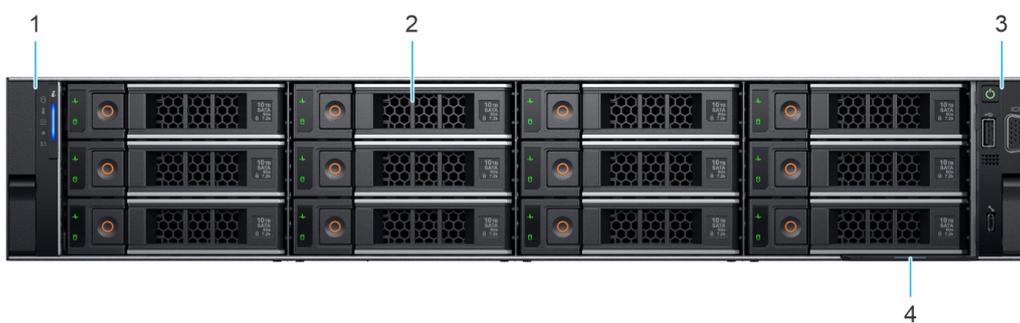


Figura 4. Vista anteriore di un sistema con 12 unità da 3,5 pollici

1. Pannello di controllo sinistro
2. Unità (12)
3. Pannello di controllo destro
4. Etichetta informativa

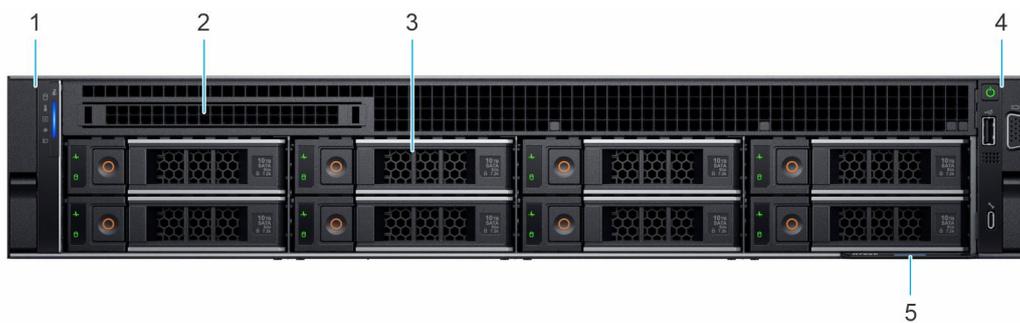
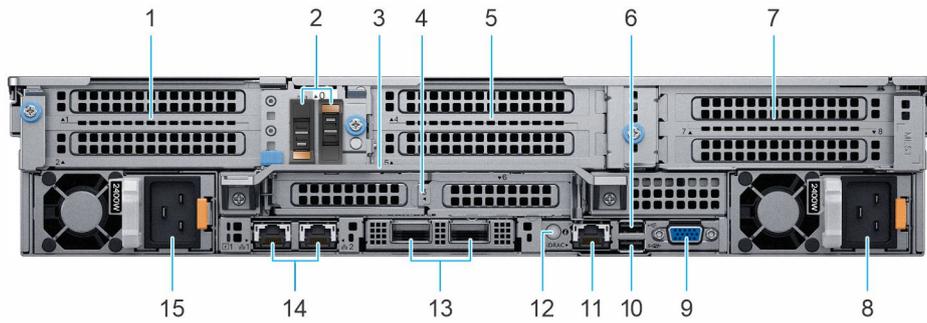


Figura 5. Vista anteriore di un sistema con 8 unità da 3,5 pollici

1. Pannello di controllo sinistro
2. Protezione dell'unità ottica
3. Unità (8)
4. Pannello di controllo destro
5. Etichetta informativa

Vista posteriore del sistema



1. Riser 1 della scheda di espansione PCIe (slot 1 e slot 2)
2. Scheda BOSS S2 (opzionale)
3. Maniglia posteriore
4. Riser 2 della scheda di espansione PCIe (slot 3 e slot 6)
5. Riser 3 della scheda di espansione PCIe (slot 4 e slot 5)
6. Porta USB 2.0 (1)
7. Riser 4 della scheda di espansione PCIe (slot 7 e slot 8)
8. Unità di alimentazione (PSU 2)
9. Porta VGA
10. Porta USB 3.0 (1)
11. Porta iDRAC dedicata
12. Pulsante di identificazione del sistema
13. Porta OCP NIC (opzionale)
14. Porta NIC (1,2)
15. Unità di alimentazione (PSU 1)

i N.B.: Consente di accedere in remoto a iDRAC.

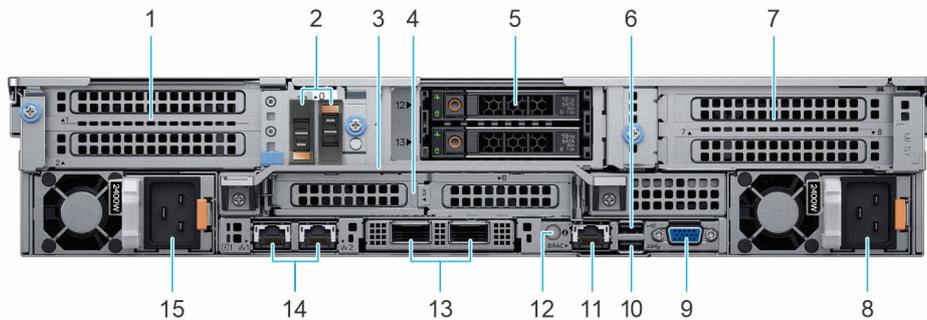


Figura 6. Vista posteriore del sistema con modulo 2 unità da 2,5 pollici

1. Riser 1 della scheda di espansione PCIe (slot 1 e slot 2)
2. Scheda BOSS S2 (opzionale)
3. Maniglia posteriore
4. Riser 2 della scheda di espansione PCIe (slot 3 e slot 6)
5. Modulo dell'unità posteriore
6. Porta USB 2.0 (1)
7. Riser 4 della scheda di espansione PCIe (slot 7 e slot 8)
8. Unità di alimentazione (PSU 2)
9. Porta VGA
10. Porta USB 3.0 (1)
11. Porta iDRAC dedicata
12. Pulsante di identificazione del sistema

i N.B.: Consente di accedere in remoto a iDRAC.

- 13. Porta OCP NIC (opzionale)
- 14. Porta NIC (1,2)
- 15. Unità di alimentazione (PSU 1)

Componenti interni del sistema

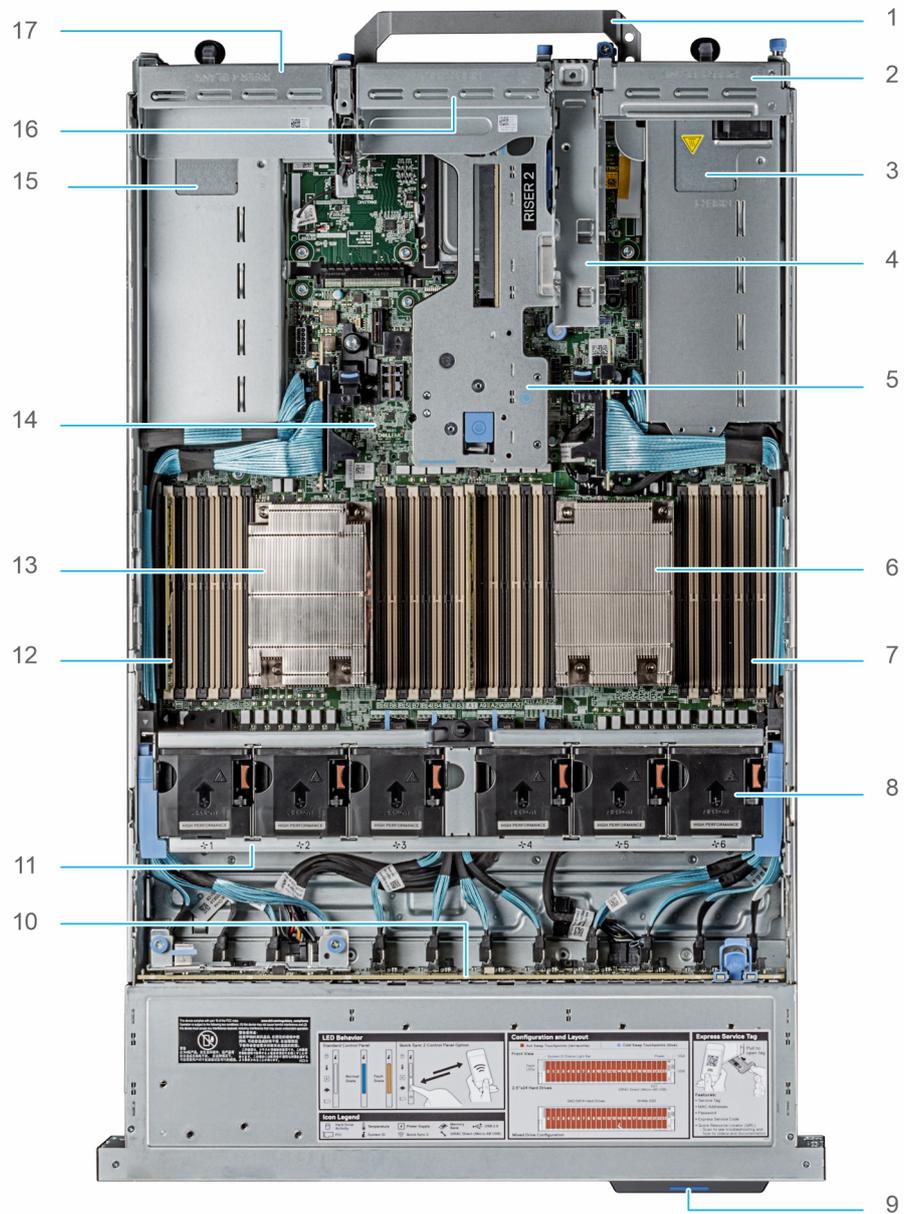


Figura 7. Componenti interni del sistema

- | | |
|--|---|
| 1. Maniglia | 2. Protezione riser 1 |
| 3. Alimentatore (PSU 1) | 4. Slot per schede BOSS S2 |
| 5. Montaggio 2 | 6. Dissipatore di calore per processore 1 |
| 7. Connettore DIMM di memoria per il processore 1 (E, F, G, H) | 8. Gruppo ventola di raffreddamento |
| 9. Codice di matricola | 10. Backplane dell'unità |
| 11. Gruppo gabbia ventola di raffreddamento | 12. Connettore DIMM di memoria per il processore 2 (A, B, C, D) |
| 13. Dissipatore di calore per processore 2 | 14. Scheda di sistema |
| 15. Alimentatore (PSU 2) | 16. Protezione riser 3 |
| 17. Protezione riser 4 | |

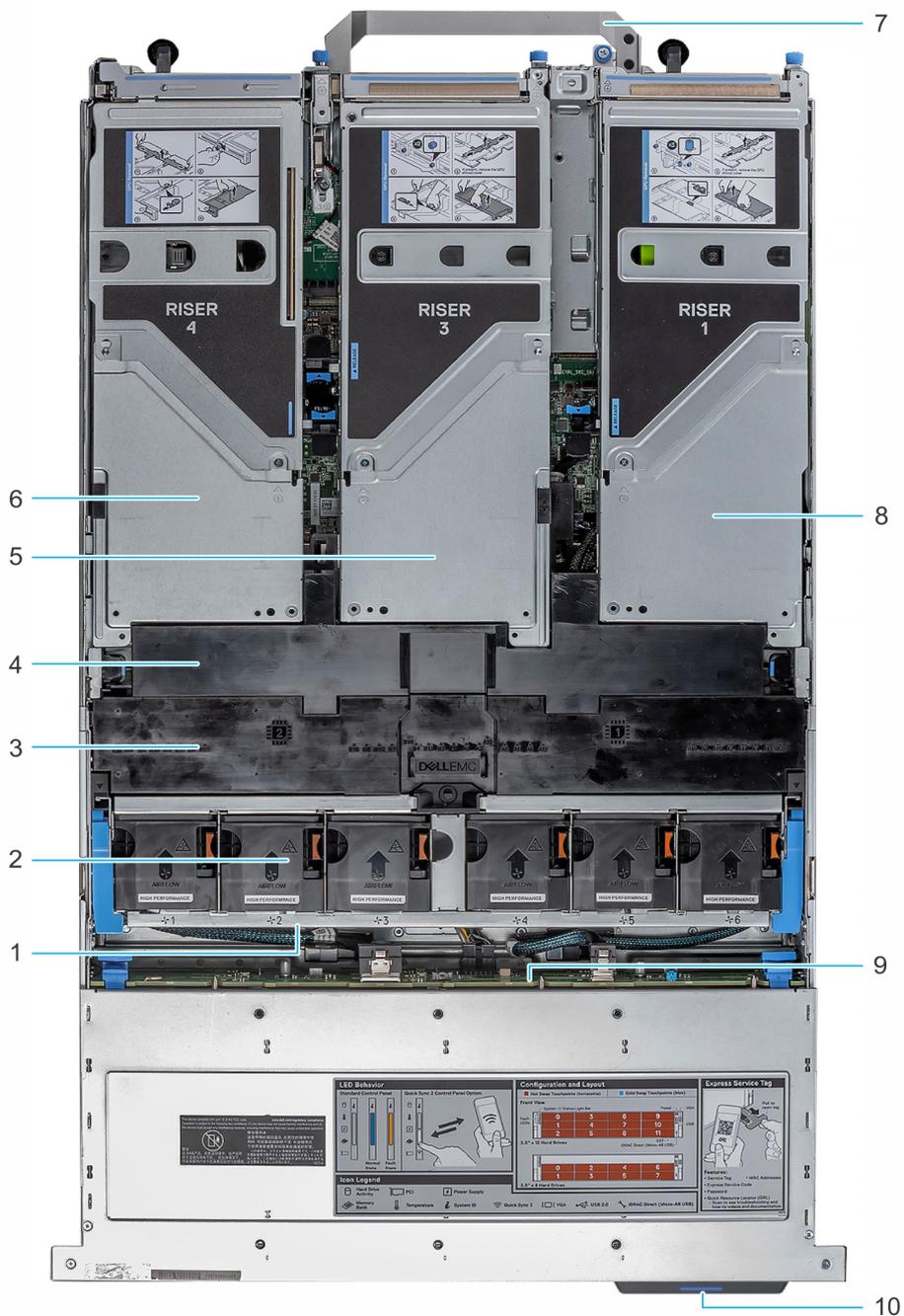


Figura 8. All'interno del sistema con riser full length

- | | |
|--|--|
| 1. Gruppo gabbia ventola di raffreddamento | 2. Ventola di raffreddamento |
| 3. Manicotto dell'aria GPU | 4. Coperchio superiore del manicotto dell'aria GPU |
| 5. Montaggio 3 | 6. Montaggio 4 |
| 7. Maniglia | 8. Montaggio 1 |
| 9. Backplane dell'unità | 10. Codice di matricola |

Quick Resource Locator per sistema PowerEdge R7525



Figura 9. Quick Resource Locator per sistema PowerEdge R7525

Processore

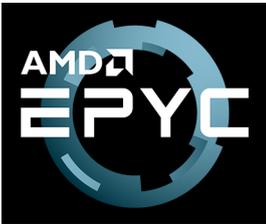


I processori AMD® EPYC™ Generazione 2 e 3 supportano fino a 64 core.

Argomenti:

- [Funzioni del processore](#)
- [Processori supportati](#)

Funzioni del processore



Le caratteristiche principali dei processori AMD® EPYC™ di seconda e terza generazione sono le seguenti:

- Supporta fino a 64 core
- Fino a 8 canali con 2 DIMM per canale (DPC) per processore e 32 DIMM in totale
- Supporta RDIMM, LRDIMM, 3DS DIMM DDR4 con ECC fino a 3.200 MT/s
- PCI Express Gen 4 integrato per migliorare larghezza di banda e connettività
- Fino a 128 corsie per processore

Configurazione a singolo processore

Il sistema è progettato in modo che un singolo processore funzioni normalmente se collocato nel socket 1. Le protezioni del processore e della memoria associate al processore 2 devono essere popolate per motivi termici. Il sistema non si avvierà se è popolato solo il socket processore 2.

Solo il riser 1 è funzionale con la configurazione a singolo processore.

Restrizioni del processore

Di seguito sono riportate le restrizioni del processore AMD EPYC:

- RTC/COMS è integrato nel processore. Pertanto, la rimozione o la reinstallazione del processore 1 provocherà la perdita di RTC/COMS.
- AMD non supporta l'avvio precoce. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore quando nel sistema non è presente alcuna memoria.

Processori supportati

Tabella 3. Processori supportati per PowerEdge R7525

Numero di modello del processore	Frequenza di base in GHz	Core/Thread	TDP in W	Memoria cache L3 in MB	Frequenza DDR max (1 DPC) MHz
7773X	3,50	64/128	280	768	3200
7573X	3,6	32/64	280	768	3200
7473X	3,70	24/48	240	768	3200
7373X	3,80	16/32	240	768	3200
7H12	2,6	64/128	280	256	3200
7763	2,45	64/128	280	256	3200
7742	2,25	64/128	225	256	3200
7713P	2,0	64/128	225	256	3200
7713	2,0	64/128	225	256	3200
7702	2,0	64/128	200	256	3200
7663	2,0	56/112	240	256	3200
7662	2,0	64/128	225	256	3200
7643	2,3	48/96	225	256	3200
7642	2,3	48/96	225	256	3200
75F3	2,95	32/64	280	256	3200
7552	2,2	48/96	200	192	3200
7543P	2,8	32/64	225	256	3200
7543	2,8	32/64	225	256	3200
7542	2,9	32/64	225	128	3200
7532	2,4	32/64	200	256	3200
7513	2,6	32/64	200	128	3200
7502	2,5	32/64	180	128	3200
74F3	3,2	24/48	240	256	3200
7453	2,75	28/56	225	64	3200
7452	2,35	32/64	155	128	3200
7443P	2,85	24/48	200	128	3200
7443	2,85	24/48	200	128	3200
7413	2,65	24/48	180	128	3200
7402	2,8	24/48	180	128	3200
73F3	3,5	16/32	240	256	3200
7352	2,3	24/48	155	128	3200
7343	3,2	16/32	190	128	3200
7313P	3,0	16/32	155	128	3200
7313	3,0	16/32	155	128	3200
7302	2,35	16/32	155	128	3200

Tabella 3. Processori supportati per PowerEdge R7525 (continua)

Numero di modello del processore	Frequenza di base in GHz	Core/Thread	TDP in W	Memoria cache L3 in MB	Frequenza DDR max (1 DPC) MHz
72F3	3,7	8/16	180	256	3200
7282	2,8	16/32	120	64	3200
7272	2,9	12/24	120	64	3200
7262	3,2	8/16	155	128	3200
7252	3,1	8/16	120	32	3200

Memoria

PowerEdge R7525 supporta fino a 32 DIMM, con un totale di 4 TB di memoria e velocità fino a 3.200 MT/s.

R7525 supporta DIMM registrati (RDIMM) e carico ridotto DIMM (LRDIMM) che utilizzano un buffer per ridurre il carico di memoria e offrire una maggiore densità, consentendo di sfruttare la massima capacità di memoria della piattaforma. I DIMM senza buffer (UDIMM) non sono supportati.

Argomenti:

- Memoria supportata
- Velocità della memoria

Memoria supportata

La seguente tabella elenca le tecnologie di memoria supportate da R7525

Tabella 4. Confronto delle tecnologie di memoria

Funzione	R7525(DDR4)
Tipo di DIMM	RDIMM
	LRDIMM
Velocità di trasferimento	3.200 MT/s
	2.933 MT/s
Tensione	1,2 V

La seguente tabella elenca i DIMM supportati da PowerEdge R7525.

Tabella 5. DIMM supportati per PowerEdge R7525

Velocità DIMM in MT/s	Tipo di DIMM	Capacità DIMM in GB	Classificazioni per DIMM	Ampiezza dati	Tensione DIMM in V	RAM massima
3200	RDIMM	8	1	8	1,2	256 GB
3200	RDIMM	16	2	8	1,2	512 GB
3200	RDIMM	32	2	8	1,2	32 GB
3200	RDIMM	32	2	4	1,2	1 TB
3200	RDIMM	64	2	4	1,2	2 TB
2666	LRDIMM	128	8	4	1,2	4 TB
3200	LRDIMM	128	4	4	1,2	4 TB

i N.B.: La precedente memoria RDIMM da 32 GB con capacità x4 e densità DRAM da 8 Gb non può essere combinata con la più recente memoria RDIMM da 32 GB con ampiezza dati x8 e densità DRAM da 16 Gb nello stesso processore AMD EPYC™.

i N.B.: La precedente memoria LRDIMM da 128 GB con capacità a 2.666 MT/s non può essere combinata con la nuova memoria LRDIMM con capacità da 128 GB alla velocità di 3.200 MT/s.

Velocità della memoria

Tabella 6. Matrice di memoria supportata

Tipo di DIMM	Rango	Capacità	Tensione nominale e velocità DIMM	Velocità operativa su processore AMD EPYC™	
				1 DIMM per canale (1 DPC)	2 DIMM per canale (2 DPC)
RDIMM	1R	8 GB	DDR4 (1,2V), 3200 MT/s	3.200 MT/s	2.933 MT/s
	2R	16 GB, 32 GB, 64 GB	DDR4 (1,2V), 3200 MT/s	3.200 MT/s	2.933 MT/s
LRDIMM	4 R	128 GB	DDR4 (1,2 V), 3.200 MT/s	3.200 MT/s	2.933 MT/s
	8R	128 GB	DDR4 (1,2V), 2666 MT/s	2666 MT/s	2666 MT/s
	8R	128 GB	DDR4 (1,2V), 3200 MT/s	3.200 MT/s	2.933 MT/s

i **N.B.:** La precedente memoria RDIMM da 32 GB con capacità x4 e densità DRAM da 8 Gb non può essere combinata con la più recente memoria RDIMM da 32 GB con ampiezza dati x8 e densità DRAM da 16 Gb nello stesso processore AMD EPYC™.

i **N.B.:** La precedente memoria LRDIMM da 128 GB con capacità a 2.666 MT/s non può essere combinata con la nuova memoria LRDIMM con capacità da 128 GB alla velocità di 3.200 MT/s.

Storage

Il sistema PowerEdge R7525 supporta le seguenti configurazioni delle unità:

- configurazione backplane 8 x 3,5 con supporto per un massimo di 8 unità SAS/SATA
- configurazione backplane 8 x 2,5 con supporto per un massimo di 8 unità NVMe
- configurazione backplane 12 x 3,5 con supporto per un massimo di 12 unità SAS/SATA
- configurazione backplane 16 x 2,5 con supporto per un massimo di 16 unità SAS/SATA
- configurazione backplane 24 x 2,5 con supporto per un massimo di 24 unità SAS/SATA/NVMe
- configurazione backplane 2 x 2,5 con supporto per un massimo di 2 unità SAS/SATA posteriori

Argomenti:

- [Controller di storage](#)
- [Unità supportate](#)
- [Unità esterne](#)

Controller di storage

Le opzioni Dell EMC per controller RAID offrono miglioramenti alle prestazioni, inclusa la soluzione Mini PERC. Mini PERC fornisce un controller RAID hardware di base senza consumare uno slot PCIe, utilizzando un fattore di forma ridotto e un connettore ad alta densità planare di base.

La seguente tabella mostra i controller di storage supportati per PowerEdge R7525:

Tabella 7. Controller di storage supportati

Performance level	Descrizione
Voce	S150 (SATA, NVMe) Software RAID SATA
Valore	H745 (interno), H345, HBA345 (interno), H840 (esterno), 12Gbps SAS HBA (esterno)
Misurazione delle prestazioni	H755N (interno), HBA355 (interno), HBA355E (esterno)

Unità supportate

Tabella 8. Unità supportate: SAS e SATA o SSD

Fattore di forma	Tipo	mem.	Velocità di rotazione	Capacità
2,5 pollici	SAS	12 Gb	10 K	300 GB, 600 GB, 1,2 TB, 1,8 TB, 1,2 TB (SED/FIPS), 2,4 TB (SED/FIPS)
	SATA	6 Gb	7,2 K	1 TB, 2 TB
	SSD SATA (M. 2)	6 Gb	Non disponibile	120 GB e 240 GB
	SSD SAS	12 Gb	Non disponibile	400 GB, 800 GB, 960 GB, 1,633 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,840 TB, 1,92 TB (SED/FIPS)
	SSD SATA	6 Gb	Non disponibile	120 GB, 200 GB, 240 GB, 300 GB, 400 GB, 480 GB, 800 GB, 960 GB, 1,2 TB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB

Tabella 8. Unità supportate: SAS e SATA o SSD (continua)

Fattore di forma	Tipo	mem.	Velocità di rotazione	Capacità
	SAS	12 Gb	15 K	300 GB, 600 GB, 900 GB
	SAS	12 Gb	7,2 K	1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 2 TB (SED/FIPS)
3,5 pollici	SATA	6 Gb	7,2 K	1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB
	SAS	12 Gb	7,2 K	1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 10 TB, 4 TB (SED FIPS), 8 TB (SED FIPS)
2,5 pollici	SSD NVMe (U.2)	Gen4	Non disponibile	960 GB, 1,92 TB, 7,68 TB, 15,36 TB

Tabella 9. SSD NVMe supportati

Descrizione
SSDR,1.6,NVMEPCI,2.5,PM1725B
SSDR,6.4,NVMEPCI,2.5,PM1725B
CRD,CTL,NVME,1.6,HHHL,PM1725B
SSDR,3.2,NVMEPCI,2.5,PM1725B
SSDR,12.8,NVMEPCI,2.5,PM1725B
CRD,CTL,NVME,3.2,HHHL,PM1725B
CRD,CTL,NVME,6.4,HHHL,PM1725B
SSDR,960GB,NVMEPCI,2.5,CD5
SSDR,3.84TB,NVMEPCI,2.5,CD5
SSD PCIe NVMe PM1735a da 1,6 TB e 2,5 pollici
SSD PCIe NVMe PM1735a da 3,2 TB e 2,5 pollici
SSD PCIe NVMe PM1735a da 6,4 TB e 2,5 pollici
SSD PCIe NVMe PM1735a da 12,8 TB e 2,5 pollici
SSD PCIe NVMe PM1733a da 1,92 TB e 2,5 pollici
SSD PCIe NVMe PM1733a da 3,8 TB e 2,5 pollici
SSD PCIe NVMe PM1733a da 7,6 TB e 2,5 pollici
SSD PCIe NVMe PM1733a da 15,36 TB e 2,5 pollici

Unità esterne

La seguente tabella mostra lo storage esterno supportato da PowerEdge R7525:

Tabella 10. Storage esterno supportato

Tipo di dispositivo	Descrizione
Nastro esterno	Supporta il collegamento a prodotti USB con nastro esterni
Software per appliance NAS/IDM	Supporta lo stack software NAS
JBOD	Supporta la connessione a JBOD serie MD da 12 Gb

Networking e PCIe

Il sistema PowerEdge R7525 supporta due porte controller di interfaccia di rete (scheda di rete) integrate sulla scheda LOM.

Il sistema PowerEdge R7525 supporta anche la porta OCP NIC integrata sulla scheda OCP opzionale.

Tabella 11. Specifiche della porta NIC

Funzione	Specifiche
Scheda LOM	1 GB x 2
Scheda OCP (OCP 3.0)	1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4, 50 GbE x 2, 100 GbE x 2

Argomenti:

- [Istruzioni per l'installazione delle schede di espansione](#)

Istruzioni per l'installazione delle schede di espansione

La tabella seguente descrive le schede di espansione supportate:

Tabella 12. Configurazioni della scheda riser della scheda di espansione

Scheda riser della scheda di espansione	Slot PCIe	Connessione del processore	Altezza	Lunghezza	Larghezza slot
Scheda riser 1	Slot 1	Processore 1	Full height	Half length	x8
					x16
	Slot 2				x8
					x16
Scheda riser 2	Slot 3	Processore 1	Basso profilo	Half length	x16
	slot 6	Processore 2			
Scheda riser 3	Slot 4	Processore 2	Full height	Half length	x8
	slot 5				x16
Scheda riser 4	slot (7)	Processore 2	Full height	Half length	x8
					x16
	Slot 8				x8
					x16

Tabella 13. Configurazioni della scheda riser PCIe

Configurazione n.	Configurazione di RSR	N. di CPU	Tipo di PERC supportato	Possibilità di storage posteriore	x8 CPU 1	x16 CPU 1	x8 CPU 2	x16 CPU 2
0	NO RSR	2	Nessuno	No	0	0	0	0

Tabella 13. Configurazioni della scheda riser PCIe (continua)

Configurazione n.	Configurazione di RSR	N. di CPU	Tipo di PERC supportato	Possibilità di storage posteriore	x8 CPU 1	x16 CPU 1	x8 CPU 2	x16 CPU 2
1	R1B	1	PERC anteriore	No	2	0	0	0
2	R1B + R4B	2	Adattatore PERC/ PERC anteriore	No	2	0	2	0
3-1	R1A + R2A + R3A + R4A (FL)	2	Adattatore PERC/ PERC anteriore	No	0	2	0	3
3-2	R1A + R2A + R3A + R4A (HL)	2	Adattatore PERC/ PERC anteriore	No	0	2	0	3
4	R1B + R2A + R3B + R4B	2	Adattatore PERC/ PERC anteriore	No	2	1	4	1
6	R1C + R2A + R3A + R4C	2	Adattatore PERC	No	0	3	0	4
7	R1D + R2A + R3B + R4D	2	Nessuno	No	0	1	2	1
8-1	R1A + R2A + R4A (FL)	2	Adattatore PERC	Sì	0	2	0	2
8-2	R1A + R2A + R4A (HL)	2	Adattatore PERC	Sì	0	2	0	2
9	R1B + R2A + R4B	2	Adattatore PERC	Sì	2	1	2	1
10	R2A + R4B	2	Adattatore PERC	Sì	0	1	2	1
11	R1D + R2A + R3B + R4B	2	Nessuno	No	0	1	4	1
12-1	R1D + R2A + R3A + R4A (FL)	2	Nessuno	No	0	1	0	3
12-2	R1D + R2A + R3A + R4A (HL)	2	Nessuno	No	0	1	0	3
13-1	R1A + R2A + R3A (FL)	2	Adattatore PERC/ PERC anteriore	No	0	2	0	2
13-2	R1A + R2A + R3A (HL)	2	Adattatore PERC/ PERC anteriore	No	0	2	0	2

Tabella 13. Configurazioni della scheda riser PCIe (continua)

Configurazione n.	Configurazione di RSR	N. di CPU	Tipo di PERC supportato	Possibilità di storage posteriore	x8 CPU 1	x16 CPU 1	x8 CPU 2	x16 CPU 2
			PERC anteriore					
14	R1B + R2A + R3B	2	Adattatore PERC/ PERC anteriore	No	2	1	2	1
15	R1D + R4D	1	Nessuno	No	0	0	0	0

i **N.B.:** Gli slot delle schede di espansione non sono di tipo sostituibili a caldo.

La seguente tabella fornisce le linee guida per l'installazione delle schede di espansione per garantire un raffreddamento adeguato e l'idoneità meccanica. Le schede di espansione con la priorità più alta devono essere installate per prime con lo slot di priorità indicato. Tutte le altre schede di espansione devono essere installate seguendo l'ordine di priorità di schede e slot.

Tabella 14. Configurazione 0 - nessuna scheda riser

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25Gb)	Slot interno	1
Modulo scheda Dell BOSS S2	Slot interno	1

Tabella 15. Configurazione 1: R1B

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Intel (NIC: 25 Gb)	1, 2	2
SolarFlare (NIC: 25 Gb)	1, 2	2
Broadcom (NIC: 25 Gb)	1, 2	2
QLogic (NIC: 25 Gb)	1, 2	2
Emulex (HBA: FC64 FH)	1, 2	2
Emulex (HBA: FC32)	1, 2	2
QLogic (HBA: FC32)	1, 2	2

Tabella 15. Configurazione 1: R1B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Emulex (HBA: FC16)	1, 2	2
QLogic (HBA: FC16)	1, 2	2
FOXCONN (HBA355E, HBA355I)	1, 2	2
Intel (NIC: 10 Gb)	1, 2	2
Broadcom (NIC: 10 Gb)	1, 2	2
QLogic (NIC: 10 Gb)	1, 2	2
Intel (NIC: 1 Gb)	1, 2	2
Broadcom (NIC: 1 Gb)	1, 2	2
Samsung (SSD PCIe)	1, 2	1
Intel (SSD PCIe)	1, 2	1
Adattatore Dell PERC	1, 2	2
Adattatore Dell BOSS	1, 2	1
Intel (NIC: 25Gb)	1, 2	2
Intel (NIC: 100Gb)	1, 2	2
Broadcom (NIC: 10Gb)	1, 2	2
Dell PERC anteriore	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 100 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 50 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Modulo scheda Dell BOSS S2	Slot interno	1

Tabella 16. Configurazione 2: R1B + R4B

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Seriale Dell	8	1
Adattatore Dell BOSS	1, 2, 7, 8	1

Tabella 16. Configurazione 2: R1B + R4B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Adattatore Dell PERC	2	1
Intel (NIC: 25 Gb)	1, 2, 7	3
Mellanox (NIC: 25 Gb)	1, 2, 3	3
SolarFlare (NIC: 25 Gb)	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb)	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC64 FH)	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32)	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32)	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC16)	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC16)	1, 2, 7	3
FOXCONN (HBA355E)	1, 2, 7, 8	2
FOXCONN (HBA355I)	2	1
Intel (NIC: 10 Gb)	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb)	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb)	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb)	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 1 Gb)	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb)	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10Gb)	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 25Gb)	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 100Gb)	1, 2, 7	3
Adattatore Dell PERC	1, 2, 7, 8	3
Samsung (SSD PCIe)	1, 2, 7, 8	3
Intel (SSD PCIe)	1, 2, 7, 8	3
Dell PERC anteriore	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 16. Configurazione 2: R1B + R4B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Modulo scheda Dell BOSS S2	Slot interno	1

Tabella 17. Configurazione 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (Full Length)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Seriale Dell	4	1
GPU: NVIDIA T4 da 16 GB (basso profilo)	3, 6	2
GPU: NVIDIA A2 da 16 GB (basso profilo)	3, 6	2
GPU: NVIDIA M10 da 32 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA A100 da 40 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA A10 da 24 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA A30 da 24 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA A40 da 48 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA V100 da 16 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA V100S da 32 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: AMD MI100 da 32 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: AMD MI210 da 64 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA RTX6000 da 24 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA RTX8000 da 48 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA RTX5000 da 16 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA A16 da 64 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA A100 da 80 GB (full height)	2, 5, 7	3
Xilinx (Acceleratori - FPGA - Full height)	2, 5, 7	3
FOXCONN (PERC anteriore)	Slot interno	1
Inventec (PERC anteriore)	Slot interno	1
Adattatore FOXCONN PERC (basso profilo)	3	1
Adattatore Inventec PERC (basso profilo)	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 17. Configurazione 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (Full Length) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
FOXCONN (HBA355E-basso profilo/full height)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100Gb, LP)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Interna	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Interna	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Interna	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Interna	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Interna	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Interna	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Interna	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Interna	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Interna	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Interna	1
FOXCONN (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Adattatore Dell BOSS S2 (basso profilo)	Interna	1
Adattatore Dell BOSS (basso profilo)	3, 6	1
Samsung (SSD PCIe)	3, 6	2
Intel (SSD PCIe)	3, 6	2
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, ANTERIORE)	Interna	1
Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, V1.1)	3,6	2
QLogic (CRD,CTL,MRVL,LP,FC32,1P,S28,F1)	3,6	2
FOXCONN (PWA,CTL,HBA355I,ADPT,V2)	3	1
FOXCONN (PWA,CTL,HBA355I,FRONT,V2)	Interna	1

Tabella 17. Configurazione 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (Full Length) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Inventec (ASSY,CRD,CTL,BOSS,ADPT,S2V2,15G)	Interna	1
Emulex (CRD,CTL,EMLX,LP,FC32,1P,S28)	3, 6	2
Intel (CRD,NTWK,INTL,FH,25G,2P,S28,F1)	Interna	1
Intel (CRD,NTWK,INTL,LP,25G,2P,S28,F1)	3, 6	2

Tabella 18. Configurazione 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (Half Length)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Seriale Dell	4	1
GPU: NVIDIA T4 da 16 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA T4 da 16 GB (basso profilo)	3, 6	2
GPU: NVIDIA A2 da 16 GB (full height)	2, 5, 7	3
GPU: NVIDIA A2 da 16 GB (basso profilo)	3, 6	2
FOXCONN (PERC anteriore)	Interna	1
Inventec (PERC anteriore)	Interna	1
Adattatore FOXCONN PERC (basso profilo)	3	1
Adattatore Inventec PERC (basso profilo)	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
NAPATECH (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC64 Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	2, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 18. Configurazione 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (Half Length) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
FOXCONN (HBA355E-basso profilo/full height)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 25Gb)	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 100Gb, FH)	2, 5, 7	3
Intel (NIC: 100Gb)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10Gb, FH)	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10Gb, LP)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	2, 5, 7	3
Broadcom (OCP: 25 Gb)	INT	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	INT	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	INT	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	INT	1
Intel (OCP: 10 Gb)	INT	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	INT	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	INT	1
Intel (OCP: 10 Gb)	INT	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	INT	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	INT	1
Intel (OCP: 1 Gb)	INT	1
Intel (OCP: 25Gb)	INT	1

Tabella 18. Configurazione 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (Half Length) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
FOXCONN (Adattatore esterno - Basso profilo)	2, 5, 7	2
FOXCONN (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Adattatore Dell BOSS S2 (basso profilo)	Interna	1
Adattatore Dell BOSS (basso profilo)	2, 5, 7	1
Adattatore Dell BOSS (basso profilo)	3, 6	1
Samsung (SSD PCIe)	3, 6, 2, 5, 7	5
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, ANTERIORE)	Interna	1
Intel (SSD PCIe)	3, 6, 2, 5, 7	5
Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32)	2, 5, 7	3
Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, V1.1)	3, 6	2
QLogic (CRD,CTL,MRVL,FH,FC32,1P,S2)8,F1)	2, 5, 7	3
QLogic (CRD,CTL,MRVL,LP,FC32,1P,S28,F1)	3, 6	2
FOXCONN (PWA,CTL,HBA355I,ADPT,V2)	3	1
FOXCONN (PWA,CTL,HBA355I,FRONT,V2)	Interna	1
Inventec (ASSY,CRD,CTL,BOSS,ADPT,S2V2,15G)	Interna	1
Emulex (CRD,CTL,EMLX,FH,FC32,1P,S28)	2, 5, 7	3
Emulex (CRD,CTL,EMLX,LP,FC32,1P,S28)	3, 6	2
Intel (CRD,NTWK,INTL,FH,25G,2P,S28,F1)	2, 5, 7	3
Intel (CRD,NTWK,INTL,LP,25G,2P,S28,F1)	3, 6	2

Tabella 19. Configurazione 4: R1B + R2A + R3A + R4B

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Seriale Dell	4, 8	1
Adattatore Dell BOSS (Full height)	1, 2, 5, 7, 8	1
Adattatore Dell PERC	2	1
Mellanox (NIC: 100 Gb - Full height)	5	1
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
SolarFlare (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 19. Configurazione 4: R1B + R2A + R3A + R4B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA: FC64 Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Full height)	5	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Full height)	5	1
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	1, 2, 5, 7, 8	1
Intel (SSD PCIe)	1, 2, 5, 7, 8	1
Dell PERC anteriore	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, ANTERIORE)	Slot interno	1

Tabella 19. Configurazione 4: R1B + R2A + R3A + R4B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 2P, V1.1)	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, V1.1)	3, 6	2

Tabella 20. Configurazione 6: R1C + R2A + R3A + R4C

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Seriale Dell	4, 8	1
GPU: NVIDIA T4 da 16 GB (full height)	1, 2, 7, 8	4
GPU: NVIDIA T4 da 16 GB (basso profilo)	3, 6	2
GPU: NVIDIA A2 da 16 GB (full height)	1, 2, 7, 8	4
GPU: NVIDIA A2 da 16 GB (basso profilo)	3, 6	2
Adattatore Dell BOSS (Full height)	1, 2, 5, 7, 8	1
Adattatore Dell BOSS (basso profilo)	3, 6	1
Adattatore Dell PERC	3	1
Mellanox (NIC: 100 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
SolarFlare (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
SolarFlare (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100Gb, FH)	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 100Gb, LP)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 20. Configurazione 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
FOXCONN (HBA355E-basso profilo/full height)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100Gb, FH)	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC: 100Gb, LP)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Full height)	1, 2, 5, 7, 8	4
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	1, 2, 5, 7, 8, 3, 6	1
Intel (SSD PCIe)	1, 2, 5, 7, 8, 3, 6	1
Dell PERC anteriore	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 20. Configurazione 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, ANTERIORE)	Slot interno	1
Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 2P, V1.1)	1, 2, 5, 7	4
Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, V1.1)	3, 6	2
QLogic (CRD,CTL,MRVL,FH,FC32,1P,S28,F1)	1, 2, 5, 7	4
QLogic (CRD,CTL,MRVL,LP,FC32,1P,S28,F1)	3, 6	2
FOXCONN (PWA,CTL,HBA355I,ADPT,V2)	5, 3	1
Emulex (CRD,CTL,EMLX,FH,FC32,1P,S28)	1, 2, 5, 7	4
Emulex (CRD,CTL,EMLX,LP,FC32,1P,S28)	3, 6	2
Intel (CRD,NTWK,INTL,FH,25G,2P,S28,F1)	1, 2, 5, 7	4
Intel (CRD,NTWK,INTL,LP,25G,2P,S28,F1)	3, 6	2

Tabella 21. Configurazione 7: R1D + R2A + R3B + R4D

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Seriale Dell	4, 8	1
Adattatore Dell BOSS (Full height)	4, 5	2
Adattatore Dell BOSS (basso profilo)	3, 6	1
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5	2
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
SolarFlare (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5	2
SolarFlare (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100Gb, FH)	5, 4	2
Broadcom (NIC: 100Gb, LP)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	5, 4	2
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	4, 5	2
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	4, 5	2
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 21. Configurazione 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	4, 5	2
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	4, 5	2
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
FOXCONN (HBA355E-basso profilo/full height)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	4, 5	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	4, 5	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Full height)	4, 5	2
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	3, 6, 4, 5	1
Intel (SSD PCIe)	3, 6, 4, 5	1
Intel (NIC: 100Gb, LP)	3, 6	2
Intel (NIC: 25Gb, FH)	5, 4	2
Intel (NIC: 100Gb, FH)	5, 4	2
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1

Tabella 21. Configurazione 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 2P, V1.1)	5, 4	2
Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, V1.1)	3, 6	2
QLogic (CRD,CTL,MRVL,FH,FC32,1P,S28,F1)	5, 4	2
QLogic (CRD,CTL,MRVL,LP,FC32,1P,S28,F1)	3, 6	2
Inventec (ASSY,CRD,CTL,BOSS,ADPT,S2V2,15G)	Slot interno	1
Emulex (CRD,CTL,EMLX,FH,FC32,1P,S28)	5, 4	2
Emulex (CRD,CTL,EMLX,LP,FC32,1P,S28)	3, 6, 4, 5	2
Intel (CRD,NTWK,INTL,FH,25G,2P,S28,F1)	5, 4	2
Intel (CRD,NTWK,INTL,LP,25G,2P,S28,F1)	3, 6	2

Tabella 22. Configurazione 8-1: R1A + R2A + R4A

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Adattatore Dell BOSS-S2	Slot interno	1
Modulo scheda Dell BOSS	3, 6	1
Adattatore Dell PERC anteriore	Slot interno	1
Adattatore Dell PERC	3	1
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 22. Configurazione 8-1: R1A + R2A + R4A (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	3, 6	1
Intel (SSD PCIe)	3, 6	1
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 23. Configurazione 8-2: R1A + R2A + R4A (HL)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Seriale Dell	8	1
Adattatore Dell BOSS-S2	Slot interno	1
Modulo scheda Dell BOSS	3, 6	1
Adattatore Dell PERC anteriore	Slot interno	1
Adattatore Dell PERC	3	1
Broadcom (NIC: 100 Gb - Full height)	2, 7	2
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Full height)	2, 7	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	2, 7	2
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Full height)	2, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
SolarFlare (NIC: 25 Gb - Full height)	2, 7	2
SolarFlare (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 23. Configurazione 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Broadcom (NIC: 25 Gb - Full height)	2, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	2, 7	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	2, 7	2
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	2, 7	2
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	2, 7	2
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	2, 7	2
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	2, 7	2
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	2, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	2, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	2, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	2, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	2, 7	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	2, 7	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Full height)	2, 7	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Full height)	2, 7	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Full height)	2, 7	2
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	2, 7, 3, 6	1
Intel (SSD PCIe)	2, 7, 3, 6	1
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1

Tabella 23. Configurazione 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 24. Configurazione 9: R1B + R2A + R4B

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Seriale Dell	8	1
Adattatore Dell BOSS (Full height)	1, 2, 7, 8	2
Adattatore Dell BOSS (basso profilo)	3, 6	1
Adattatore Dell PERC	3, 2	1
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100Gb, FH)	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 100Gb, LP)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
SolarFlare (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
SolarFlare (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	1, 2, 7	3
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	1, 2, 7	3
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	1, 2, 7	3

Tabella 24. Configurazione 9: R1B + R2A + R4B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
FOXCONN (HBA355E-basso profilo/full height)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Full height)	1, 2, 7	3
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	3, 6, 1, 2, 7, 8	1
Intel (SSD PCIe)	3, 6, 1, 2, 7, 8	1
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, ANTERIORE)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 2P, V1.1)	1, 2, 7	3

Tabella 24. Configurazione 9: R1B + R2A + R4B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, V1.1)	3, 6	2
QLogic (CRD,CTL,MRVL,FH,FC32,1P,S28,F1)	1, 2, 7	3
QLogic (CRD,CTL,MRVL,LP,FC32,1P,S28,F1)	3, 6	2
FOXCONN (PWA,CTL,HBA355I,ADPT,V2)	3	1
FOXCONN (PWA,CTL,HBA355I,FRONT,V2)	Slot interno	1
Inventec (ASSY,CRD,CTL,BOSS,ADPT,S2V2,15G)	Slot interno	1
Emulex (CRD,CTL,EMLX,FH,FC32,1P,S28)	1, 2, 7	3
Emulex (CRD,CTL,EMLX,LP,FC32,1P,S28)	3, 6	2
Intel (CRD,NTWK,INTL,FH,25G,2P,S28,F1)	1, 2, 7	3
Intel (CRD,NTWK,INTL,LP,25G,2P,S28,F1)	3, 6	2

Tabella 25. Configurazione 10: R2A + R4B

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Adattatore Dell BOSS-S2	Slot interno	1
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (full height)	7, 8	1
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (basso profilo)	3, 6	1
Adattatore Dell PERC anteriore	Slot interno	1
Adattatore Dell PERC	3	1
FOXCONN (HBA355I)	3	1
FOXCONN (HBA355E, H840)	3, 6, 7	3
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	7	1
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	7	1
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	7	1
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	7	1
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	7	1
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	7	1

Tabella 25. Configurazione 10: R2A + R4B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	7	1
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	7	1
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Full height)	7, 8	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Full height)	7	1
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	7	1
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	7	1
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	7	1
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	7	1
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Full height)	7	1
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	3, 6	1
Intel (SSD PCIe)	3, 6	1
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 26. Configurazione 11: R1D + R2A + R3B + R4B

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Porta seriale Dell	4, 8	2
Adattatore Dell BOSS-S2	Slot interno	1
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (full height)	4, 5, 7, 8	4
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (basso profilo)	3, 6	2
FOXCONN (HBA355E, H840, HBA - 12 GB/S) (full height/low profile)	3, 4, 5, 6, 7	5
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	4, 5, 7	3
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	4, 5, 7	3
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Full height)	4, 5, 7, 8	4
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5, 7	3
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	4, 5, 7	3
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 26. Configurazione 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5, 7	3
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Full height)	4, 5, 7	3
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
Intel (SSD PCIe)	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 27. Config12-1: R1D+R2A+R3A+R4A(FL)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Adattatore Dell BOSS-S2	Slot interno	1
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (basso profilo)	3, 6	2
FOXCONN (HBA355E, H840, HBA - 12 GB/S) (full height/low profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 27. Config12-1: R1D+R2A+R3A+R4A(FL) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Xilinx (FPGA - Full Height)	5, 7	2
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	3, 6	2
Intel (SSD PCIe)	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 28. Configurazione 12-2:R1D+R2A+R3A+R4A (HL)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Porta seriale Dell	4, 8	2
Adattatore Dell BOSS-S2	Slot interno	1
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (full height)	5, 7	2
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (basso profilo)	3, 6	2
FOXCONN (HBA355E, H840, HBA - 12 GB/S) (full height/low profile)	3, 6, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 100 Gb - Full height)	5, 7	2
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Full height)	5, 7	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 28. Configurazione 12-2:R1D+R2A+R3A+R4A (HL) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	5, 7	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	5, 7	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	5, 7	2
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	5, 7	2
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	5, 7	2
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb - Full Height)	5, 7	2
Intel (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	5, 7	2
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	5, 7	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	5, 7	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Full height)	5, 7	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Full height)	5, 7	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	5, 7	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	5, 7	2
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	5, 7	2
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	5, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Full height)	5, 7	2
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	3, 6, 5, 7	4
Intel (SSD PCIe)	3, 6, 5, 7	4
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1

Tabella 28. Configurazione 12-2:R1D+R2A+R3A+R4A (HL) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 29. Configurazione 13-1: R1A+R2A+R3A (FL)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Adattatore Dell BOSS-S2	Slot interno	1
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (basso profilo)	3, 6	2
FOXCONN (HBA355E, H840, HBA - 12 GB/S) (full height/low profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 29. Configurazione 13-1: R1A+R2A+R3A (FL) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3	1
Samsung (SSD PCIe)	3, 6	2
Intel (SSD PCIe)	3, 6	2
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 30. Configurazione 13-2: R1A+R2A+R3A (HL)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Porta seriale Dell	4, 8	2
Adattatore Dell BOSS-S2	Slot interno	1
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (full height)	2, 5	2
Modulo della scheda Dell BOSS-S1 (basso profilo)	3, 6	2
FOXCONN (HBA355E, H840, HBA - 12 GB/S) (full height/low profile)	3, 6, 5, 7	4
Broadcom (NIC: 100 Gb - Full height)	2, 5	2
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Full height)	2, 5	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	2, 5	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	2, 5	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	2, 5	2
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	2, 5	2
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 30. Configurazione 13-2: R1A+R2A+R3A (HL) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	2, 5	2
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb - Full Height)	2, 5	2
Intel (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	2, 5	2
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	2, 5	2
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	2, 5	2
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Full height)	2, 5	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Full height)	2, 5	2
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	2, 5	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	2, 5	2
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	2, 5	2
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	5, 7	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Dell (Adattatore esterno - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	3, 6, 2, 5	4
Intel (SSD PCIe)	3, 6, 2, 5	4
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1

Tabella 30. Configurazione 13-2: R1A+R2A+R3A (HL) (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 31. Configurazione 14: R1B + R2A + R3B

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Dell PERC anteriore	Slot interno	1
Seriale Dell	8	1
Adattatore Dell BOSS (Full height)	1, 2, 7, 8	2
Adattatore Dell BOSS (basso profilo)	3, 6	1
FOXCONN (HBA355E, H840) (full height/low profile)	3, 6, 4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (HBA - 12 GB/S) (Full height)	4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (HBA - 12 GB/S) (Low profile)	3, 6	2
Adattatore Dell PERC	3, 2	1
Broadcom (NIC: 100 Gb - Low Profile)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Broadcom (NIC: 1 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC64 - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC64 - Low profile)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC32 - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
Emulex (HBA: FC16 - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb - Full Height)	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 100 Gb - Low profile)	3, 6	2
Intel (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Intel (NIC: 1 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC: 1 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: 100 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Mellanox (NIC: 100 Gb - Basso profilo)	3, 6	2

Tabella 31. Configurazione 14: R1B + R2A + R3B (continua)

Tipo scheda	Priorità di slot	Numero massimo di schede
Mellanox (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
Mellanox (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Basso profilo)	4, 5, 1, 2	4
Mellanox (NIC:HDR VPI - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 25 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC: 25 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC32 - Full height)	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC32 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (HBA: FC16 - Full height)	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC16 - Basso profilo)	3, 6	2
QLogic (NIC: 10 Gb - Full height)	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC: 10 Gb - Basso profilo)	3, 6	2
Samsung (SSD PCIe)	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
Intel (SSD PCIe)	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, ANTERIORE)	Slot interno	1
Intel (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Tabella 32. Configurazione 15: R1D + R4D

Tipo scheda	Fornitore	Categoria
Adattatore Dell BOSS-S2	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Mellanox (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
SolarFlare (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1

Tabella 32. Configurazione 15: R1D + R4D (continua)

Tipo scheda	Fornitore	Categoria
Intel (OCP: 25 Gb)	Slot interno	1
Intel (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
QLogic (OCP: 10 Gb)	Slot interno	1
Broadcom (OCP: 1 Gb)	Slot interno	1

Alimentazione, termica e acustica

Argomenti:

- Alimentazione
- Termico
- Acustica

Alimentazione

Il sistema PowerEdge R7525 dispone di un'ampia gamma di sensori che controllano automaticamente le attività termiche, aiutando a regolare la temperatura e riducendo il rumore e il consumo energetico.

Tabella 33. Strumenti e tecnologie di alimentazione

Funzione	Descrizione
Portafoglio PSU	Il portafoglio PSU di Dell EMC include funzionalità intelligenti, ad esempio l'ottimizzazione dinamica del consumo energetico e la ridondanza.
Conformità del settore	I server Dell EMC sono conformi a tutte le principali certificazioni e linee guida del settore, tra cui 80 PLUS, Climate Saver ed ENERGY STAR.
Accuratezza del monitoraggio dell'alimentazione	I miglioramenti di PSU Power Monitoring includono: <ul style="list-style-type: none"> • Accuratezza del monitoraggio dell'1%, inferiore allo standard del settore del 5% • Maggiore precisione di reporting di alimentazione • Prestazioni migliori in caso di limiti di alimentazione
Power capping	Utilizzare il software di gestione dei sistemi Dell EMC per impostare il limite di alimentazione del sistema e limitare l'output di un PSU e ridurre il consumo energetico del sistema.
Gestione dei sistemi	iDRAC Enterprise fornisce una gestione a livello di server che monitora, segnala e controlla il consumo energetico a livello di processore, memoria e sistema. Dell OpenManage Power Center fornisce una gestione dell'alimentazione del gruppo a livello di rack, riga e data center per i server, le unità di distribuzione dell'alimentazione e i gruppi di continuità.
Gestione dell'alimentazione	Node Manager è una tecnologia integrata che fornisce funzionalità di reporting di alimentazione e limitazione di potenza individuali. La tecnologia hot-spare riduce il consumo energetico di alimentatori ridondanti.
Supporto per aria fresca	Vedere dell.com/fresh-air-cooling
Infrastruttura rack	Dell EMC offre alcune delle soluzioni per l'infrastruttura di alimentazione più efficienti del settore, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> • Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) • gruppi di continuità (UPS) • Enclosure per rack di contenimento Energy Smart Per ulteriori informazioni, vedere: http://content.dell.com/us/en/enterprise/power-and-cooling-technologies-components-rack-infrastructure.aspx .

Termico

La gestione termica della piattaforma aiuta a garantire un raffreddamento a prestazioni elevate ai componenti, mantenendo al contempo la velocità della ventola più bassa possibile. Questa operazione viene eseguita su un'ampia gamma di temperature ambientali che variano da 10°C a 35 °C, (da 50°F a 95 °F) e a intervalli di temperatura estesi.

La progettazione termica del sistema PowerEdge R7525 riflette quanto segue:

- Progettazione termica ottimizzata: architettura integrata nel layout di sistema.
- Il posizionamento e il layout dei componenti di sistema sono progettati per offrire la massima copertura del flusso d'aria ai componenti critici, con un consumo energetico minimo per la ventola.
- Gestione termica completa ottenuta regolando la velocità della ventola sulla base di diverse risposte di tutti i sensori di temperatura dei vari componenti del sistema, nonché dell'inventario per le configurazioni di sistema. Il monitoraggio della temperatura include componenti come processori, DIMM, chipset, ambiente d'aria negli ingressi del sistema, unità disco e riser LOM.
- Il controllo della ventola termica a circuito aperto e chiuso utilizza la configurazione di sistema per determinare la velocità della ventola in base alla temperatura ambiente dell'aria in ingresso. Il metodo di controllo termico a circuito chiuso utilizza le temperature di feedback per determinare dinamicamente le velocità appropriate della ventola.
- Impostazioni configurabili dall'utente nella schermata di configurazione del BIOS di iDRAC.

La ridondanza di raffreddamento delle ventole N+1 garantisce continuità di funzionamento anche in caso di guasto di una ventola nel sistema.

Acustica

PowerEdge R7525 è un server con montaggio su rack appropriato per l'ambiente data center assistito. Tuttavia, un output acustico inferiore è raggiungibile con adeguate configurazioni hardware o software. Ad esempio, la configurazione minima di R7525 è sufficientemente silenziosa per l'ambiente tipico di ufficio.

Tabella 34. Prestazioni acustiche PowerEdgeR7525

Configurazione	Immissione/Minimo	Volume/tipico	GPU	Nessun backplane	Scatola NVMe	Volume/tipico 3
Categoria acustica	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 5	Categoria 3	Categoria 5	Categoria 5
CPU	1 x 120 W	2 x 180 W	2 x 180 W	2 x 180 W	2 x 225 W	2 x 120 W
Memoria	8 RDIMM da 8 GB	8 RDIMM da 8 GB	8 RDIMM da 8 GB	8 RDIMM da 8 GB	8 RDIMM da 32GB	16 RDIMM da 16 GB
Configurazione di storage: fronte, interno, retro, PCIe	8 da 3,5 pollici	16 x 2,5 pollici	16 x 2,5 pollici	0 dischi rigidi	24 da 2,5 pollici, NVMe	12 unità da 3,5 pollici + 2 unità da 2,5 pollici (posteriori)
Schede	H345	H745	H740	H745	PCI da 100 GB	H745
	OCP 2 x 10 G	25 GB a 2 porte	GPU double-width	25 GB a 2 porte	OCP 2 x 25 GB	10 GB a 1 porte
	LOM Down, 1-GB	OCP 1025 G	OCP 2 x 25 G	OCP 1025 G	M.2	OCP 1025 G
		M.2	M.2	M.2	LOM Down, 1-GB	M.2
		LOM Down, 1-GB	LOM Down, 1-GB	LOM Down, 1-GB		LOM Down, 1-GB

La progettazione acustica del sistema PowerEdge R7525 riflette quanto segue:

- Versatilità: PowerEdge R7525 consuma meno energia nel data center. Inoltre, è abbastanza silenzioso per gli uffici in configurazioni tipiche e minime.
- Elevati standard di qualità audio: la qualità del suono è diversa dal livello di potenza sonora e dal livello di pressione sonora in quanto descrive il modo in cui gli esseri umani rispondono a un suono fastidioso, come fischi e mormorii. Una delle metriche di qualità audio nelle specifiche Dell è il rapporto di risalto di un tono.

- Rampa di rumore e discesa all'avvio da spegnimento: velocità della ventola e livelli di rumore aumentano durante il processo di avvio (dallo spegnimento all'accensione) per aggiungere un livello di protezione al raffreddamento dei componenti quando il sistema non è in grado di avviarsi correttamente. Per mantenere il processo di avvio il più silenzioso possibile, la velocità della ventola raggiunta durante l'avvio è limitata a circa metà della velocità massima.
- Dipendenze livello rumore: se l'acustica è importante per l'utente, è necessario considerare diverse scelte e impostazioni di configurazione:
 - Per un output acustico inferiore, utilizzare alcuni dischi rigidi SATA con velocità di rotazione minore, dischi rigidi NL-SAS o dispositivi non a rotazione come SSD. I dischi rigidi da 15k generano un rumore acustico superiore rispetto ai dischi rigidi con velocità inferiori. Inoltre, il rumore aumenta con il numero di dischi rigidi.
 - La velocità e il rumore della ventola possono aumentare dalle configurazioni di fabbrica baseline quando alcuni profili vengono modificati dall'utente, oppure le configurazioni di sistema vengono aggiornate. Di seguito è riportato un elenco di elementi che influiscono sulle velocità della ventola e sull'output acustico:
 - Impostazioni del BIOS iDRAC9: prestazioni per watt, DAPC o sistema operativo, possono essere meno rumorose rispetto alle prestazioni o alla configurazione ad alta densità (**iDRAC Settings > Thermal > Max. Exhaust Temperature or Fan speed offset**).
 - Quantità e tipo di schede di PCIe installate: ciò influisce sull'acustica complessiva del sistema. L'installazione di più di due schede PCIe genera un incremento dell'acustica complessiva del sistema.
 - Utilizzo di una scheda GPU: la scheda GPU genera un aumento dell'acustica complessiva del sistema.
 - Unità SSD basate su controller PCIe: le unità, come le unità Express Flash e le schede Fusion IO, richiedono un maggiore flusso d'aria per il raffreddamento e comportano livelli di rumore più alti.
 - Sistemi con un PERC H330: questa configurazione può essere più tranquilla rispetto alle configurazioni con un PERC H740P con la batteria di riserva. Tuttavia, livelli di rumore più alti si verificano quando un sistema è configurato come non RAID.
 - Funzione hot-spare dell'unità di alimentazione: nell'impostazione predefinita del sistema, la funzione hot-spare è disabilitata. L'uscita acustica degli alimentatori è la più bassa in questa impostazione.

Sistemi operativi supportati

PowerEdge R7525 supporta i seguenti sistemi operativi:

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix XenServer
- Microsoft Windows Server con Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware vSAN/ESXi

Per maggiori informazioni, consultare www.dell.com/ossupport.

Dell Technologies Services

Dell Technologies Services include una vasta gamma di opzioni di assistenza personalizzabili per semplificare l'assessment, la progettazione, l'implementazione, la gestione e la manutenzione degli ambienti IT e per facilitare la transizione da una piattaforma all'altra. A seconda degli attuali requisiti aziendali e del livello di assistenza, forniamo servizi di fabbrica, in loco, in remoto, modulari e specializzati che soddisfano le esigenze e il budget dei clienti. A seconda della scelta del cliente, l'assistenza sarà poca o molta, e avrà accesso alle risorse globali.

Per maggiori informazioni, consultare DellEMC.com/Services.

Argomenti:

- [Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite](#)
- [Dell EMC Remote Consulting Services](#)
- [Dell EMC Data Migration Service](#)
- [Dell EMC ProSupport Enterprise Suite](#)
- [Dell EMC ProSupport Plus for Enterprise](#)
- [Dell EMC ProSupport for Enterprise](#)
- [Dell EMC ProSupport One for Data Center](#)
- [ProSupport per HPC](#)
- [Tecnologie di supporto](#)
- [Servizi di formazione Dell Technologies](#)
- [Servizi di consulenza Dell Technologies](#)
- [Servizi gestiti Dell EMC](#)

Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite

ProDeploy Enterprise Suite permette di rendere subito operativo un server appena acquistato. I nostri tecnici di implementazione, con un'esperienza ampia e profonda che utilizza processi best-in-class, e la nostra estensione globale possono aiutare in qualsiasi luogo e momento. Dalle installazioni dei server semplici a quelle più complesse e all'integrazione del software, garantiamo un deployment delle nuove tecnologie server senza rischi.

		Basic Deployment	ProDeploy	ProDeploy Plus
Pre-deployment	Single point of contact for project management	-	●	In-region
	Site readiness review	-	●	●
	Implementation planning	-	●	●
	SAM engagement for ProSupport Plus entitled devices	-	-	●
Deployment	Deployment service hours	Business hours	24x7	24x7
	Remote guidance for hardware installation or Onsite hardware installation and packaging material removal	Onsite	Remote or Onsite	Onsite
	Install and configure system software	-	Remote	Onsite
	Install support software and connect with Dell Technologies	-	●	●
	Project documentation with knowledge transfer	-	●	●
Post-deployment	Deployment verification	-	●	●
	Configuration data transfer to Dell EMC technical support	-	●	●
	30-days of post-deployment configuration assistance	-	-	●
	Training credits for Dell EMC Education Services	-	-	●

Figura 10. Funzionalità di ProDeploy Enterprise Suite

 **N.B.:** L'installazione dell'hardware non è applicabile su determinati prodotti software.

Dell EMC ProDeploy Plus

Dall'inizio alla fine, ProDeploy Plus fornisce l'abilità e la scalabilità necessarie per eseguire correttamente deployment complessi negli ambienti IT variegati di oggi. Gli esperti Dell EMC certificati iniziano con valutazioni ambientali estensive e con la pianificazione e le raccomandazioni dettagliate sulla migrazione. L'installazione del software comprende la maggior parte delle versioni delle utilità di gestione dei sistemi Dell EMC SupportAssist e OpenManage. Sono inoltre disponibili servizi di assistenza per la configurazione post-installazione, test e orientamento ai prodotti.

Dell EMC ProDeploy

ProDeploy offre l'installazione e la configurazione complete dell'hardware server e del software di sistema da parte di tecnici di implementazione certificati, inclusa la configurazione di sistemi operativi e hypervisor leader, nonché la maggior parte delle versioni delle utilità di gestione del sistema Dell EMC SupportAssist e OpenManage. Per prepararsi all'installazione, è possibile eseguire un'analisi dell'idoneità del sito e un'attività di pianificazione dell'installazione. Test del sistema, convalida e documentazione completa del progetto con il trasferimento delle conoscenze completeranno il processo.

Basic Deployment

Basic Deployment offre un'installazione professionale senza problemi da parte di tecnici esperti che conoscono approfonditamente i server Dell EMC.

Servizi di configurazione dei server Dell EMC

Con l'integrazione rack e altri servizi di configurazione del server Dell EMC PowerEdge si risparmia tempo ricevendo i sistemi in rack, cablati, testati e pronti per l'integrazione nel data center. Il personale Dell EMC preconfigura le impostazioni RAID, BIOS e iDRAC, installa le immagini di sistema e installa anche hardware e software di terze parti.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Servizi di configurazione server](#).

Servizi di residenza Dell EMC

I servizi di residenza consentono ai clienti di passare rapidamente a nuove funzionalità con l'assistenza di esperti Dell EMC in sede o in remoto, gestendone priorità e tempistiche. Gli esperti di residenza possono fornire gestione post-implementazione e trasferimento delle conoscenze in relazione a una nuova acquisizione tecnologica o alla gestione operativa giornaliera dell'infrastruttura IT.

Dell EMC Remote Consulting Services

Quando ci si trova nelle fasi finali dell'implementazione del server PowerEdge, è possibile fare affidamento a Dell EMC Remote Consulting Services e ai nostri esperti tecnici certificati per ottimizzare la configurazione con le best practice per il software, la virtualizzazione, server, storage, networking e gestione dei sistemi.

Dell EMC Data Migration Service

Proteggi il business e i dati con il nostro singolo punto di contatto per gestire il progetto di migrazione dei dati. Il Project Manager collaborerà con il nostro esperto team di esperti per creare un piano che utilizzi strumenti leader del settore e processi comprovati sulla base delle best practice globali per migrare i file e i dati esistenti, in modo che il sistema aziendale sia operativo rapidamente e correttamente.

Dell EMC ProSupport Enterprise Suite

Con ProSupport Enterprise Suite garantiamo il corretto funzionamento dei sistemi IT. In questo modo potrai concentrarti sul tuo business. Manterrai le prestazioni di picco e avrai a disposizione i workload più essenziali. ProSupport Enterprise Suite è una suite di servizi di supporto che consentono di creare la soluzione giusta per la tua organizzazione.

È possibile scegliere modelli di supporto in base al modo in cui si utilizza la tecnologia e in cui si desidera allocare le risorse. Dal desktop al data center, puoi affrontare le sfide IT quotidiane, ad esempio tempi di inattività non pianificati, esigenze mission-critical, protezione dei dati e degli asset, pianificazione del supporto, allocazione delle risorse, gestione delle applicazioni software e altro ancora. Ottimizza le risorse IT scegliendo il modello di supporto corretto.



Figura 11. Dell EMC ProSupport Enterprise Suite

Dell EMC ProSupport Plus for Enterprise

Quando si acquista un server PowerEdge, si consiglia ProSupport Plus, il nostro servizio di supporto proattivo e preventivo per i sistemi business-critical. ProSupport Plus fornisce tutti i vantaggi di ProSupport, oltre a quanto segue:

- Un Services Account Manager assegnato che conosce business e ambiente
- Risoluzione dei problemi avanzata e immediata da parte di un tecnico che comprende il server PowerEdge
- Suggerimenti personalizzati e preventivi basati sull'analisi delle tendenze del supporto e delle best practice provenienti da tutta la base clienti delle soluzioni di infrastruttura Dell Technologies per ridurre i problemi di supporto e migliorare le prestazioni
- Analisi predittiva per la prevenzione e l'ottimizzazione dei problemi abilitata da SupportAssist
- Monitoraggio proattivo, rilevamento dei problemi, notifica e creazione automatica di casi per la risoluzione dei problemi accelerati abilitati da SupportAssist
- Suggerimenti su reporting on-demand e sull'analisi, abilitati da SupportAssist e TechDirect

Dell EMC ProSupport for Enterprise

Il nostro servizio di ProSupport offre esperti altamente qualificati in tutto il mondo e in qualsiasi momento per soddisfare le tue esigenze di IT. Siamo in grado di ridurre al minimo le interruzioni e massimizzare la disponibilità di workload dei server PowerEdge con:

- Supporto 24/7 tramite telefono, chat e online
- Strumenti predittivi e automatizzati e tecnologie innovative
- Un punto di riferimento centrale per tutti i problemi hardware e software
- Supporto collaborativo di terze parti
- Supporto per Hypervisor, sistema operativo e applicazioni
- Esperienza coerente indipendentemente dalla posizione e dalla lingua
- Scelta tra componenti in loco e manodopera, tra cui opzioni di risposta entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata o quattro ore per i processi mission critical

i **N.B.:** Soggetto a modifiche in base alla disponibilità dell'offerta nel proprio Paese.

Enterprise Support Services Feature Comparison

	Basic	ProSupport	ProSupport Plus
Remote technical support	9x5	24x7	24x7
Covered products	Hardware	Hardware Software	Hardware Software
Onsite hardware support	Next business day	Next business day or 4hr mission critical	Next business day or 4 hr mission critical
3 rd party collaborative assistance		●	●
Automated issue detection & proactive case creation		●	●
Self-service case initiation and management		●	●
Access to software updates		●	●
Priority access to specialized support experts			●
3 rd party software support			●
Assigned Services Account Manager			●
Personalized assessments and recommendations			●
Semiannual systems maintenance			●

Availability and terms of Dell Technologies services vary by region and by product. For more information, please view our Service Descriptions available on Dell.com

Figura 12. Modello di supporto di Dell EMC Enterprise

Dell EMC ProSupport One for Data Center

ProSupport One for Data Center offre supporto flessibile a livello di sito per data center di grandi dimensioni e distribuiti con più di 1.000 asset. Questa offerta è basata su componenti ProSupport standard che sfruttano la scalabilità globale, ma su misura per le esigenze dell'azienda. Anche se non per tutti, questa opzione di servizio offre una soluzione veramente unica per i clienti più grandi di Dell Technologies con gli ambienti più complessi.

- Team di Service Account Manager assegnati con opzioni remote e in loco.
- Tecnico ProSupport One e tecnici di campo assegnati e certificati per ambiente e configurazioni
- Suggerimenti su reporting on-demand e sull'analisi, abilitati da SupportAssist e TechDirect
- Supporto flessibile in sede e opzioni di componenti adatte al modello operativo
- Un piano di supporto e formazione personalizzato per il personale operativo

ProSupport per HPC

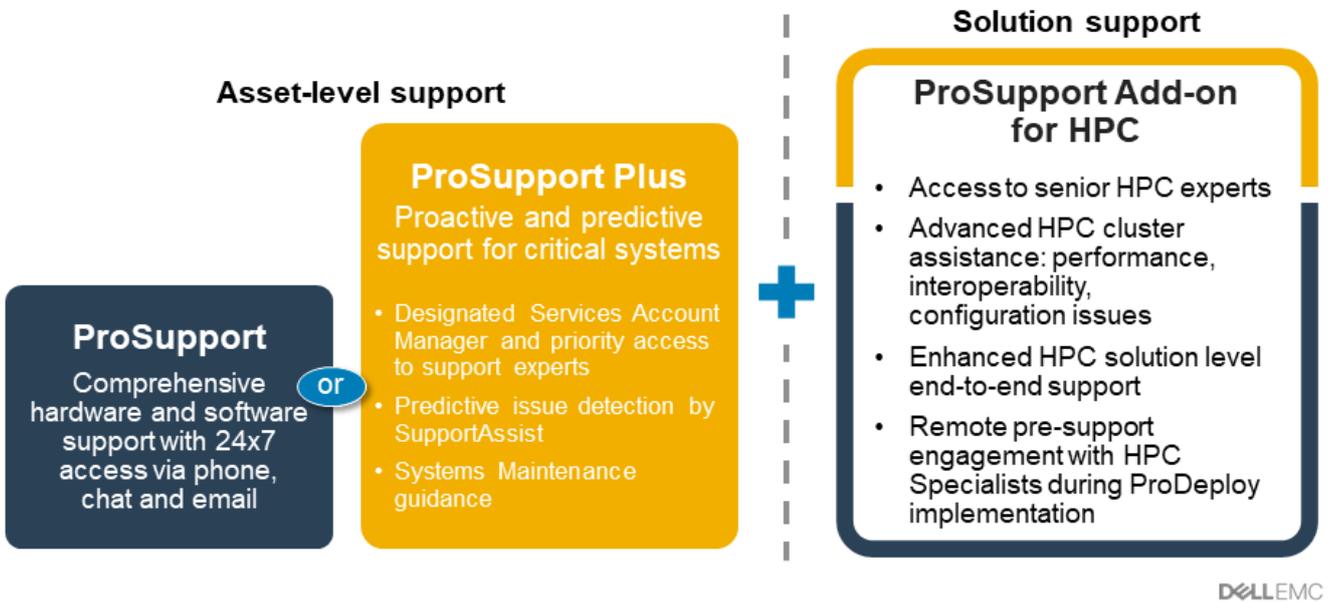
ProSupport per HPC fornisce supporto contestuale con le soluzioni, tra cui:

- Accesso a esperti HPC senior
- Assistenza avanzata per cluster HPC: prestazioni, interoperabilità e configurazione
- Supporto completo per il livello di soluzione HPC avanzato
- Contatto di presupporto remoto con esperti HPC durante l'implementazione di ProDeploy

Ulteriori informazioni su DellEMC.com/HPC-Services.

ProSupport Add-on for HPC

Delivering a true end-to-end support experience across your HPC environment



8 © Copyright 2020 Dell Inc.

DELL EMC

Figura 13. ProSupport per HPC

Tecnologie di supporto

Migliora l'esperienza di supporto con tecnologie predittive e basate su dati.

Dell EMC SupportAssist

Il momento migliore per risolvere un problema è prima che si verifichi. La tecnologia proattiva, predittiva e automatizzata di SupportAssist aiuta a ridurre le fasi e i tempi di risoluzione, spesso rilevando problemi prima che diventino gravi. I vantaggi comprendono:

- Valore: SupportAssist è disponibile per tutti i clienti senza costi aggiuntivi
- Migliora la produttività: sostituisci le routine manuali e complesse con il supporto automatizzato
- Accelerazione del time-to-resolution: ricezione di avvisi sui problemi, creazione automatica di casi e contatto proattivo da parte di esperti Dell EMC
- Acquisizione di informazioni utili e controllo: ottimizzazione dei dispositivi aziendali con reporting on demand di ProSupport Plus in TechDirect e rilevamento predittivo dei problemi prima che si verifichino.

N.B.: SupportAssist è incluso in tutti i piani di supporto, ma le funzionalità variano in base al contratto del livello di servizio.

	Basic Hardware Warranty	ProSupport	ProSupport Plus
Automated issue detection and system state information collection	•	•	•
Proactive, automated case creation and notification		•	•
Predictive issue detection for failure prevention			•
Recommendation reporting available on-demand in TechDirect			•

Figura 14. Modello di SupportAssist

Iniziare visitando Dell.com/SupportAssist

Dell EMC TechDirect

Incrementa la produttività del team IT quando si supportano sistemi Dell EMC. Con oltre 1,4 milioni di spedizioni automatiche elaborate ogni anno, TechDirect ha dimostrato la propria efficacia come strumento di supporto. È possibile:

- Spedizione automatica delle parti di ricambio
- Richiesta di supporto tecnico
- Integrazione delle API nell'helpdesk

Oppure accesso a tutti i requisiti di certificazione e autorizzazione di Dell EMC. Formazione del personale su prodotti Dell EMC, in quanto TechDirect consente di:

- Scarica le guide di studio
- Pianifica esami di certificazioni e autorizzazioni
- Visualizza le trascrizioni dei corsi e degli esami completati

Registrati su techdirect.dell.

Servizi di formazione Dell Technologies

Crea le competenze IT necessarie per influenzare i risultati della trasformazione del business. Promuovi il talento e i team con le competenze giuste per condurre ed eseguire la strategia di trasformazione che permette di ottenere un vantaggio competitivo. Utilizzare la formazione e la certificazione necessarie per una vera trasformazione.

Dell Technologies Education Services offre formazione e certificazione su server PowerEdge pensate per aiutare l'utente a ottenere di più dall'investimento hardware. Il programma di studio fornisce le informazioni e le competenze pratiche di cui utenti e team hanno bisogno per devono installare, configurare, gestire e risolvere i problemi dei server Dell EMC in modo sicuro. Per ulteriori informazioni o per registrarsi a un corso, visitare LearnDell.com/Server.

Servizi di consulenza Dell Technologies

I nostri esperti consulenti aiutano a trasformare rapidamente i risultati aziendali per i workload di alto valore, gestibili al meglio dai sistemi Dell EMC PowerEdge.

Dalla strategia all'implementazione su larga scala, Dell Technologies Consulting può aiutare a determinare come eseguire la trasformazione IT, del personale o delle applicazioni.

Utilizziamo approcci prescrittivi e metodologie comprovate combinati con il portafoglio di Dell Technologies e l'ecosistema partner per aiutare a ottenere risultati aziendali concreti. Da multi-cloud, applicazioni, DevOps e trasformazioni dell'infrastruttura, alla resilienza di business, la modernizzazione del data center, l'analisi, la collaborazione della forza lavoro e le esperienze degli utenti, siamo qui per aiutarti.

Servizi gestiti Dell EMC

Riduci i costi, la complessità e il rischio di gestione. Concentra le risorse su innovazione e trasformazione digitale, mentre i nostri esperti contribuiscono a ottimizzare le operazioni IT e gli investimenti con i servizi gestiti, supportati a livelli di servizio garantiti.

OpenManage Systems Management di Dell EMC

Dell EMC OpenManage Portfolio

Simplifying hardware management through ease of use and automation

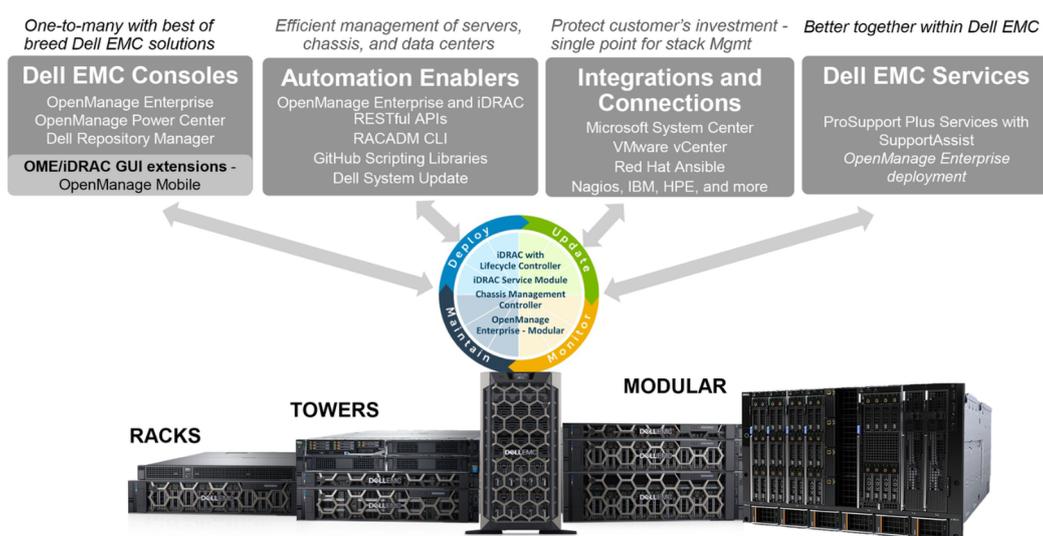


Figura 15. Dell EMC OpenManage Portfolio

Dell EMC offre soluzioni di gestione che consentono agli amministratori IT di implementare, aggiornare, monitorare e gestire in modo efficace gli asset IT. Le soluzioni e gli strumenti OpenManage consentono di rispondere rapidamente ai problemi aiutando a gestire i server Dell EMC in modo efficace ed efficiente; in ambienti fisici, virtuali, locali e remoti; lavorando in banda e fuori banda; tutto senza la necessità di installare un agent nel sistema operativo. Il portafoglio di OpenManage include innovativi strumenti di gestione incorporati come il Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC), Chassis Management Controller e le console come OpenManage Enterprise, OpenManage Power Manager plug-in e strumenti come Repository Manager.

Dell EMC ha sviluppato soluzioni complete di gestione dei sistemi basate su standard aperti e ha integrato le console di gestione che possono eseguire la gestione avanzata dell'hardware Dell. Dell EMC ha connesso o integrato le funzionalità di gestione avanzate dell'hardware Dell in offerte di fornitori e framework di gestione dei sistemi top del settore, come Ansible, rendendo così le piattaforme Dell EMC semplici da implementare, aggiornare, monitorare e gestire.

Gli strumenti chiave per la gestione dei server Dell EMC PowerEdge sono iDRAC e la console di Enterprise OpenManage one-to-many. OpenManage Enterprise aiuta i System Administrator a completare la gestione del ciclo di vita di più generazioni di server PowerEdge. Altri strumenti, ad esempio repository Manager, che consentono una gestione delle modifiche semplice ma completa.

Gli strumenti di OpenManage si integrano con il framework di gestione dei sistemi di altri vendor, ad esempio VMware, Microsoft, Ansible e ServiceNow. Ciò consente di utilizzare le competenze del personale IT per gestire in modo efficiente Dell EMC PowerEdge Server.

Argomenti:

- Server e responsabili dello chassis
- Console Dell EMC
- Enabler di automazione
- Integrazione con le console di terze parti
- Connessioni per console di terze parti
- Utilità di aggiornamento Dell EMC

- [Risorse di Dell](#)

Server e responsabili dello chassis

- Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
- iDRAC Service Module (ISM)

Console Dell EMC

- Dell EMC OpenManage Enterprise
- Dell EMC Repository Manager (DRM)
- Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager plug-in OpenManage Enterprise
- Dell EMC OpenManage Mobile (OMM)

Enabler di automazione

- OpenManage Ansible Modules
- API iDRAC RESTful (Redfish)
- API basate su standard (Python, PowerShell)
- Interfaccia della riga di comando RACADM (CLI o Command Line Interface)
- Librerie di scripting GitHub

Integrazione con le console di terze parti

- Integrazioni di Dell EMC OpenManage con Microsoft System Center
- Integrazione Dell EMC OpenManage per VMware vCenter (OMIVV)
- Moduli di Dell EMC OpenManage Ansible
- Integrazione di Dell EMC OpenManage con ServiceNow

Connessioni per console di terze parti

- Micro focus e altri strumenti HPE
- Connessione OpenManage per IBM Tivoli
- Plug-in OpenManage per Nagios Core e XI

Utilità di aggiornamento Dell EMC

- Dell System Update (DSU)
- Dell EMC Repository Manager (DRM)
- Pacchetti di aggiornamento Dell EMC (DUP)
- Dell EMC Server Update Utility (SUU)
- Dell EMC Platform Specific Bootable ISO (PSBI)

Risorse di Dell

Per ulteriori informazioni su White paper, video, blog, forum, materiale tecnico, strumenti, esempi di utilizzo e altre informazioni, consultare la pagina OpenManage alla pagina <https://www.dell.com/openmanagemanuals> o le seguenti pagine di prodotti:

Tabella 35. Risorse di Dell

Risorsa	Posizione
Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)	https://www.dell.com/idracmanuals
iDRAC Service Module (iSM)	https://www.dell.com/support/kbdoc/000178050/
OpenManage Ansible Modules	https://www.dell.com/support/kbdoc/000177308/
OpenManage Essentials (OME)	https://www.dell.com/support/kbdoc/000175879/
OpenManage Mobile (OMM)	https://www.dell.com/support/kbdoc/000176046
OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV)	https://www.dell.com/support/kbdoc/000176981/
OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC)	https://www.dell.com/support/kbdoc/000147399
Dell EMC Repository Manager (DRM)	https://www.dell.com/support/kbdoc/000177083
Dell EMC System Update (DSU)	https://www.dell.com/support/kbdoc/000130590
Dell EMC Platform Specific Bootable ISO (PSBI)	Dell.com/support/article/sln296511
Dell EMC Chassis Management Controller (CMC)	www.dell.com/support/article/sln311283
OpenManage Connections for Partner Consoles	https://www.dell.com/support/kbdoc/000146912
OpenManage Enterprise Power Manager	https://www.dell.com/support/kbdoc/000176254
OpenManage Integration with ServiceNow (OMISNOW)	Dell.com/support/article/sln317784

 **N.B.:** Le funzioni possono variare a seconda del server. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla pagina del prodotto <https://www.dell.com/manuals>.

Appendice A. Specifiche aggiuntive

Argomenti:

- Dimensioni dello chassis
- Peso dello chassis
- Specifiche video
- Specifiche delle porte USB
- Specifiche ambientali

Dimensioni dello chassis

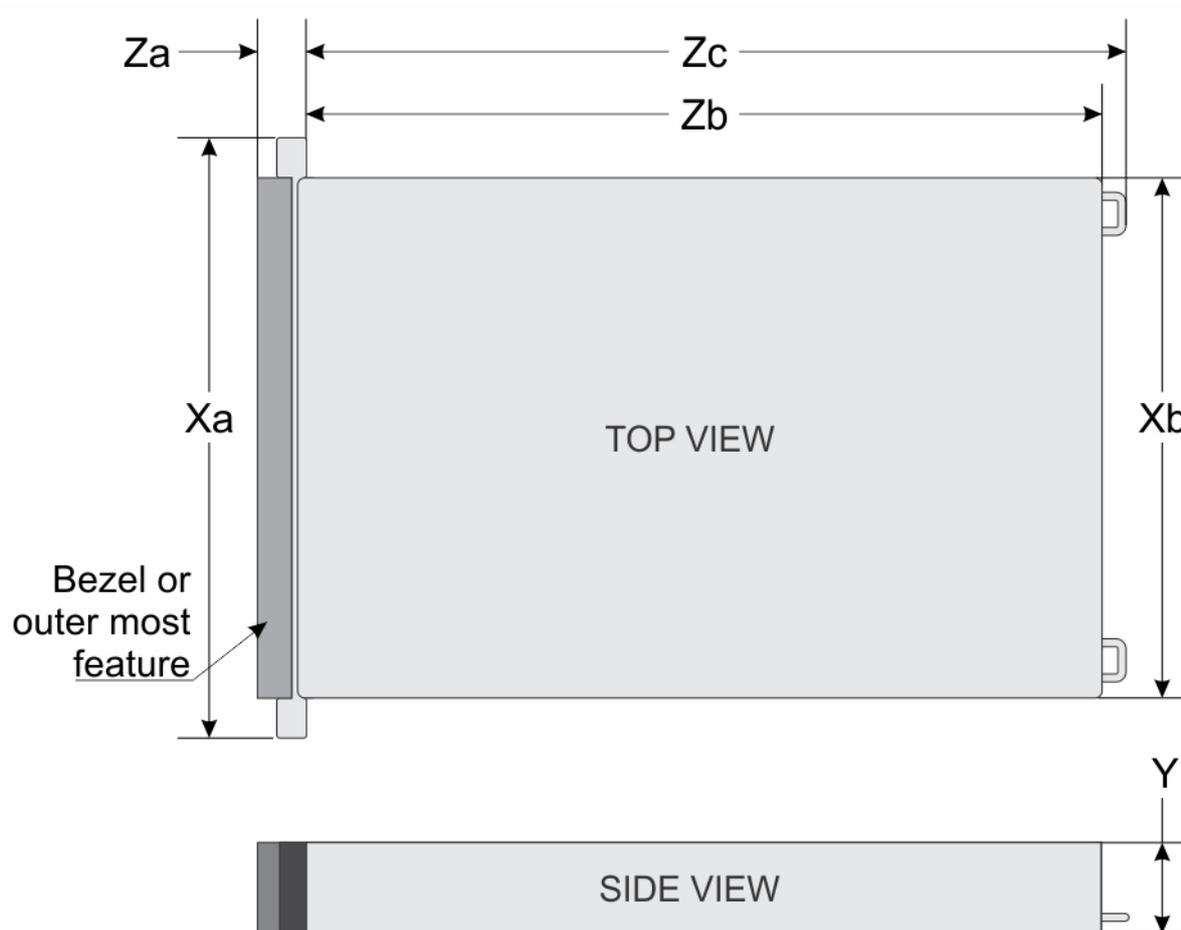


Figura 16. Dimensioni dello chassis

Tabella 36. PowerEdge R7525

Unità	Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
12 unità	482,0 mm (18,97 pollici)	434,0 mm (17,08 inches)	86,8 mm 3,41 pollici	Con cornice: 35,84 mm (1,4 pollici)	700,7 mm (27,58 inches)	736,29 mm (28,98 inches)

Tabella 36. PowerEdge R7525 (continua)

Unità	Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
				Senza cornice: 22,0 mm (0,87 pollici)	(Da orecchio a parete posteriore)	(Da orecchio a maniglia PSU)
24 unità	482,0 mm (18,97 pollici)	434,0 mm (17,08 inches)	86,8 mm 3,41 pollici	Con cornice: 35,84 mm (1,4 pollici) Senza cornice: 22,0 mm (0,87 pollici)	700,7 mm (27,58 inches) (Da orecchio a parete posteriore)	736,29 mm (28,98 inches) (Da orecchio a maniglia PSU)

i **N.B.:** Zb si riferisce alla superficie esterna nominale della parete posteriore, dove si trovano i connettori I/O della scheda di sistema.

Peso dello chassis

Tabella 37. PowerEdge R7525

Configurazione del sistema	Peso massimo (con tutte le unità/SSD)
12 x 3,5 pollici	36,3 kg (80,02 lb)
8 x 3,5 pollici	33,2 kg (73,19 lb)
24 x 2,5 pollici	28,6 kg (63,05 lb)
16 x 2,5 pollici	26,6 kg (58,64 lb)
8 x 2,5 pollici	24,6 kg (54,23 lb)

Specifiche video

Il sistema PowerEdge R7525 supporta il controller grafico Matrox G200 integrato con 16 MB di frame buffer video.

Tabella 38. Opzioni di risoluzione video anteriori supportate

Risoluzione	Frequenza di refresh (Hz)	Profondità del colore (bit)
1024 X 768	60	8, 16, 32
1280 X 800	60	8, 16, 32
1280 X 1024	60	8, 16, 32
1360 X 768	60	8, 16, 32
1440 X 900	60	8, 16, 32

Tabella 39. Opzioni di risoluzione video posteriori supportate

Risoluzione	Frequenza di refresh (Hz)	Profondità del colore (bit)
1024 X 768	60	8, 16, 32
1280 X 800	60	8, 16, 32
1280 X 1024	60	8, 16, 32
1360 X 768	60	8, 16, 32
1440 X 900	60	8, 16, 32
1600 x 900	60	8, 16, 32

Tabella 39. Opzioni di risoluzione video posteriori supportate (continua)

Risoluzione	Frequenza di refresh (Hz)	Profondità del colore (bit)
1600 X 1200	60	8, 16, 32
1680 X 1050	60	8, 16, 32
1.920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 X 1200	60	8, 16, 32

Specifiche delle porte USB

Tabella 40. Specifiche USB del sistema PowerEdge R7525

Anteriore		Parte posteriore		Interno (opzionale)	
Tipo di porta USB	No. di porte	Tipo di porta USB	No. di porte	Tipo di porta USB	No. di porte
Porta USB compatibile 2.0	Uno	Porte USB compatibili 3.0	Uno	Una porta interna conforme a USB 3.0	Uno
Porta conforme a micro-USB 2.0	Uno	Porte USB compatibili 2.0	Uno		

- i** **N.B.:** La porta conforme a micro USB 2.0 può essere utilizzata solo come porta iDRAC Direct o porta di gestione.
- i** **N.B.:** Le specifiche USB 2.0 forniscono un'alimentazione di 5 V su un singolo cavo per alimentare i dispositivi USB. Un carico unitario è definito come 100 mA in USB 2.0 e 150 mA in USB 3.0. Un dispositivo può ricavare un massimo di 5 unità (500 mA) da una porta in USB 2.0; 6 (900 mA) in USB 3.0.
- i** **N.B.:** L'interfaccia USB 2.0 è in grado di fornire alimentazione alle periferiche a basso consumo, ma deve aderire alle specifiche USB. È necessaria una fonte di alimentazione esterna per far funzionare le periferiche di maggiore potenza, come le unità CD/DVD esterne.

Specifiche ambientali

- i** **N.B.:** Per ulteriori informazioni sulle certificazioni ambientali, fare riferimento al *data sheet ambientale del prodotto* nei Manuali e documenti alla pagina www.dell.com/support/home.

Tabella 41. Categoria operativa di fascia climatica A2

Temperatura	Specifiche
Funzionamento continuo consentito	
Intervalli di temperatura per altitudine <= 900 metri (<= 2.953 piedi)	Da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) senza luce solare diretta sull'apparecchio.
Intervalli di percentuale di umidità (sempre in assenza di condensa)	Da 8% RH con punto di rugiada minimo a -12 °C a 80% RH a 21 °C (69,8 °F) punto di rugiada massimo
Altitudine di esercizio non classificata	La temperatura massima è ridotta di 1 °C per ogni 300 m (33,8°F/984 piedi) sopra i 900 m (2.953 piedi).

Tabella 42. Categoria operativa di fascia climatica A3

Temperatura	Specifiche
Funzionamento continuo consentito	
Intervalli di temperatura per altitudine <= 900 metri (<= 2.953 piedi)	Da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F) senza luce solare diretta sull'apparecchio.

Tabella 42. Categoria operativa di fascia climatica A3 (continua)

Temperatura	Specifiche
Intervalli di percentuale di umidità (sempre in assenza di condensa)	Da 8% RH con punto di rugiada minimo a -12 °C a 85% RH a 24°C (75,2°F) punto di rugiada massimo
Altitudine di esercizio non classificata	La temperatura massima è ridotta di 1 °C per ogni 175 m (33,8°F/574 piedi) sopra i 900 m (2.953 piedi).

Tabella 43. Categoria operativa di fascia climatica A4

Temperatura	Specifiche
Funzionamento continuo consentito	
Intervalli di temperatura per altitudine <= 900 metri (<= 2.953 piedi)	Da 5 °C a 45 °C (da 41 °F a 113 °F) senza luce solare diretta sull'apparecchio.
Intervalli di percentuale di umidità (sempre in assenza di condensa)	Da 8% RH con punto di rugiada minimo a -12 °C a 90% RH a 24°C (75,2°F) punto di rugiada massimo
Altitudine di esercizio non classificata	La temperatura massima è ridotta di 1 °C per ogni 125 m (33,8°F/410 piedi) sopra i 900 m (2.953 piedi).

Tabella 44. Requisiti condivisi in tutte le categorie

Temperatura	Specifiche
Funzionamento continuo consentito	
Gradiente di temperatura massima (si applica sia al funzionamento che al non funzionamento)	20 °C in un'ora* (36 °F in un'ora) e 5 °C in 15 minuti (41°F in 15 minuti), 5 °C in un'ora * (41°F in un'ora) per hardware su nastro  N.B.: *: Per le linee guida termiche ASHRAE per hardware su nastro, non si tratta di tassi istantanei di variazione della temperatura.
Limiti di temperatura con sistema non in funzione	Da -40°C a 65°C (da -104°F a 149°F)
Limiti di umidità con sistema non in funzione	dal 5% al 95% di umidità relativa con 27°C (80,6°F) punto massimo di rugiada.
Altitudine massima con sistema non in funzione	12.000 m (39.370 piedi)
Altezza massima con sistema in funzione	3.048 m (10.000 piedi)

Tabella 45. Specifiche di vibrazione massima

Vibrazione massima	Specifiche
In esercizio	0,26 G _{rms} da 5 Hz a 350 Hz (tutti gli orientamenti di funzionamento)
Storage	1,88 G _{rms} da 10 Hz a 500 Hz per 15 min (tutti e sei i lati testati).

Tabella 46. Specifiche degli impulsi d'urto massimo

Impulsi d'urto massimo	Specifiche
In esercizio	Sei impulsi d'urto consecutivi in direzioni positive e negative degli assi x, y e z di 6 G per un massimo di 11 ms.
Storage	Sei impulsi d'urto consecutivi in direzioni positive e negative degli assi x, y e z (un impulso su ciascun lato del sistema) di 71 G per un tempo massimo di 2 ms.

Matrice delle restrizioni termiche

Tabella 47. Matrice delle restrizioni termiche

Configurazioni	NVM e con 8 unità da 2,5 pollici	SAS con 16 unità da 2,5 pollici	NVM e con 16 unità da 2,5 pollici	SAS con 24 unità da 2,5 pollici				16 unità SAS da 2,5 pollici + 8 unità NVMe da 2,5 pollici	24 da 2,5 pollici, NVMe	8 unità da 3,5 pollici	12 da 3,5 pollici			Temperatura ambiente	
	Storage posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	2 unità posteriori da 2,5 pollici senza ventola posteriore	4 unità posteriori da 2,5 pollici con ventola posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	2 unità posteriori da 2,5 pollici senza ventola posteriore	4 unità posteriori da 2,5 pollici con ventola posteriore		
TDP/ cTDP CPU	120 W	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	35°C	
	155 W	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	35°C	
	170 W	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola STD STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	Ventola HPR STD HSK 1U	35°C	
	180 W	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	35°C
	200 W	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	35°C
	225 W	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola HPR	Ventola HPR	Ventola STD	Ventola HPR	Ventola STD	Ventola HPR	Ventola HPR	Ventola HPR	Ventola HPR	35°C

Tabella 47. Matrice delle restrizioni termiche (continua)

Configurazio ne	NVM e con 8 unità da 2,5 pollici	SAS con 16 unità da 2,5 pollici	NVM e con 16 unità da 2,5 pollici	SAS con 24 unità da 2,5 pollici			16 unità SAS da 2,5 pollici + 8 unità NVMe da 2,5 pollici	24 da 2,5 pollici, NV Me	8 unità da 3,5 pollici	12 da 3,5 pollici			Tempe ratura ambien te	
	Storage posteriore	Ness una unità posteriore	Ness una unità posteriore	Ness una unità posteriore	Nessun a unità posteriore	2 unità posteriori da 2,5 pollici senza ventola posteriore	4 unità posteriori da 2,5 pollici con ventola posteriore	Nessun a unità posteriore	Nes suna unit à posteriori	Nessun a unità posteriore	Nessun a unità posteriore	2 unità posteriori da 2,5 pollici senza ventola posteriore		4 unità posteriori da 2,5 pollici con ventola posteriore
		HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	HSK Full 2U	
	240 W	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	35°C
	280 W - 64 C	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD* HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola VHP HSK Full 2U	Ventola STD* HSK Full 2U	Ventola HPR* HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola HPR* HSK Full 2U	Ventola HPR* HSK Full 2U	Ventola HPR* HSK Full 2U	35°C
	280 W - 32 C	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD* HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola VHP HSK Full 2U	Ventola STD* HSK Full 2U	Ventola HPR* HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	-	-	-	35°C
	280 W - 64 C/32 C	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	Ventola STD* HSK Full 2U	Ventola HPR HSK Full 2U	Ventola VHP HSK Full 2U	Ventola STD* HSK Full 2U	Ventola HPR* HSK Full 2U	Ventola STD HSK Full 2U	-	-	-	35°C
	280 W - 24 C/16 C	Ventola VHP	Ventola VHP	Ventola VHP HSK Full 2U										

Tabella 47. Matrice delle restrizioni termiche (continua)

Configurazio ne	NVM e con 8 unità da 2,5 pollici	SAS con 16 unità da 2,5 pollici	NVM e con 16 unità da 2,5 pollici	SAS con 24 unità da 2,5 pollici				16 unità SAS da 2,5 pollici + 8 unità NVMe da 2,5 pollici	24 da 2,5 pollici, NV Me	8 unità da 3,5 pollici	12 da 3,5 pollici			Tempe ratura ambien te
	Storage posteriore	Ness una unità posteriore	Ness una unità posteriore	Ness una unità posteriore	Nessun a unità posteriore	2 unità posteriori da 2,5 pollici senza ventola posteriore	4 unità posteriori da 2,5 pollici con ventola posteriore	Nessun a unità posteriore	Nes suna unità à posteriore	Nessun a unità posteriore	Nessun a unità posteriore	2 unità posteriori da 2,5 pollici senza ventola posteriore	4 unità posteriori da 2,5 pollici con ventola posteriore	
		HSK Full 2U	HSK Full 2U											
LRDI MM 128 GB	-	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola HPR (Silver)	Ventola HPR (Silver)	Ventola STD	Ventola HPR (Silver)	Ventola STD	Ventola HPR (Silver))*, se TDP ≥ 200 W	Ventola HPR (Silver))*, se TDP ≥ 170 W	Ventola HPR (Silver))*	35°C

i **N.B.:** * La temperatura ambiente supportata è di 30 °C.

i **N.B.:** Sono necessari tre moduli a ventola per un singolo processore e 6 moduli per ventole nei sistemi a doppio processore.

Tabella 48. Raffreddamento ad aria e raffreddamento a liquido: matrice di restrizione termica GPU/FPGA

Con figu razi one (sto rage ante riore)	Tipo della ventola	Max TDP/ cTDP CPU	GPU/FPGA (temperatura ambiente)															
			T4	V10 0 (16 GB)	V10 0S	M10	Sno w whit e	RTX 600 0	RTX 800 0	A100	MI10 0	A40	A10	A30	A16	MI21 0	A2	
Nes sun back plan e	HPR (Silver)	280 W	30 °C	35 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C
NV Me con 8 unità da 2,5 pollici	HPR (Silver)	280 W	30 °C	35 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C
SAS con 16	HPR (Silver)	280 W	30 °C	35 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C

Tabella 48. Raffreddamento ad aria e raffreddamento a liquido: matrice di restrizione termica GPU/FPGA (continua)

Configurazione (storage anteriore)	Tipo della ventola	Max TDP/cTDP CPU	GPU/FPGA (temperatura ambiente)														MI210	A2
			T4	V100 (16 GB)	V100S	M10	Snowwhite	RTX 6000	RTX 8000	A100	MI100	A40	A10	A30	A16			
unità da 2,5 pollici																		
NVMe con 16 unità da 2,5 pollici	HPR (Gold)	280 W	30 °C	35 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C
16 unità SAS da 2,5 pollici + 8 unità NVMe da 2,5 pollici	HPR (Gold)	280 W	30 °C	35 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C
SAS con 8 unità da 3,5 pollici	HPR (Silver)	280 W	30 °C	35 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C	30 °C	35 °C	35 °C	35 °C	30 °C

i **N.B.:** La GPU non è supportata nella configurazione con 12 dischi rigidi da 3,5 pollici e 24 unità NVMe da 2,5 pollici.

i **N.B.:** Le schede T4 a basso profilo e full height sono installate per supportare un massimo di 6 PC T4 negli slot x 16.

i **N.B.:** Nel sistema di raffreddamento a liquido sono supportate massimo due GPU DW.

Tabella 49. Matrice del processore e del dissipatore di calore

Dissipatore di calore	Processore TDP
STD HSK	< 180 W

Tabella 49. Matrice del processore e del dissipatore di calore (continua)

Dissipatore di calore	Processore TDP
HPR (Silver) HSK 2U	>= 180 W
HSK di tipo L	Supporta tutti i TDP (il sistema deve essere installato con schede GPU/FGPA/Long PCIe)

i **N.B.:** Tutte le schede GPU/FGPA necessitano di un manicotto HSK e GPU 1U di tipo L.

Tabella 50. Riferimenti dell'etichetta

Etichetta	Descrizione
STD	Standard
HPR (Silver)	Prestazioni elevate (Silver)
HPR (Gold)	Prestazioni elevate (Gold)
HSK	Dissipatore di calore
LP	Basso profilo
FH	Full height

Tabella 51. Raffreddamento a liquido: restrizioni termiche della CPU (non GPU/FGPA)

Configurazione		NVMe con 8 unità da 2,5 pollici	SAS con 16 unità da 2,5 pollici	NVMe con 16 unità da 2,5 pollici	16 unità SAS da 2,5 pollici + 8 unità NVMe da 2,5 pollici	24 da 2,5 pollici, NVMe	8 unità da 3,5 pollici	12 da 3,5 pollici	
Storage posteriore		Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	2 unità posteriori da 2,5 pollici senza ventola posteriore
TDP/cTDP CPU	120 W	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	155 W	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	170 W	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	180 W	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	200 W	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	225 W	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)

Tabella 51. Raffreddamento a liquido: restrizioni termiche della CPU (non GPU/FPGA) (continua)

Configurazione		NVMe con 8 unità da 2,5 pollici	SAS con 16 unità da 2,5 pollici	NVMe con 16 unità da 2,5 pollici	16 unità SAS da 2,5 pollici + 8 unità NVMe da 2,5 pollici	24 da 2,5 pollici, NVMe	8 unità da 3,5 pollici	12 da 3,5 pollici	
Storage posteriore		Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	2 unità posteriori da 2,5 pollici senza ventola posteriore
	240 W	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	280 W	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)

Tabella 52. Raffreddamento a liquido: restrizioni termiche della memoria (non GPU/FPGA)

Configurazione		1 DPC	2 DPC	NVMe con 8 unità da 2,5 pollici	SAS con 16 unità da 2,5 pollici	NVMe con 16 unità da 2,5 pollici	16 unità SAS da 2,5 pollici + 8 unità NVMe da 2,5 pollici	24 da 2,5 pollici, NVMe	8 unità da 3,5 pollici	12 da 3,5 pollici	
Storage posteriore				Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	Nessuna unità posteriore	2 unità posteriori da 2,5 pollici senza ventola posteriore
Memoria	8 GB RDIM M 3200	2,8	2,0	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	16 GB RDIM M 3200	4,3	3,0	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	32 GB RDIM M 3200	6,9	4,8	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	64 GB RDIM M 3200	8,3	5,8	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A4)	Ventola STD (supporto A3)
	128 GB LRDIM M 2666	12,4	9,9	Ventola STD	Ventola STD (supporto A3)	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD	Ventola STD (supporto A3)	Ventola STD (supporto A3)	Ventola STD (supporto A3)

Appendice B. Conformità agli standard

Il sistema è conforme ai seguenti standard del settore.

Tabella 53. Documenti standard del settore

Standard	URL per informazioni e specifiche
Specifiche ACPI (Advance Configuration and Power Interface), v 2.0 c	https://uefi.org/specsandtesttools
Ethernet IEEE 802.3-2005	https://standards.ieee.org/
HDG Hardware Design Guide versione 3.0 per Microsoft Windows Server	microsoft.com/whdc/system/platform/pcdesign/designguide/serverdg.mspx
IPMI Intelligent Platform Management Interface, versione 2.0	intel.com/design/servers/ipmi
Memoria DDR4 Specifiche DDR4 SDRAM	jedec.org/standards-documents/docs/jesd79-4.pdf
PCI Express specifiche di base PCI Express versioni 2,0 e 3,0	pcsig.com/specifications/pciexpress
PMBus Specifiche Power System Management Protocol, v 1.2	http://pmbus.org/Assets/PDFS/Public/PMBus_Specification_Part_1_Rev_1-1_20070205.pdf
SAS Serial Attached SCSI v 1.1	http://www.t10.org/
SATA Serial ATA versione 2.6; SATA II, estensioni SATA 1.0 a, versioni 1.2	sata-io.org
SMBIOS specifiche di riferimento System Management BIOS, v 2.7	dmtf.org/standards/smbios
TPM specifiche Trusted Platform Module, v 1.2 e v 2.0	trustedcomputinggroup.org
UEFI specifiche Unified Extensible Firmware Interface, v 2.1	uefi.org/specifications
USB Specifiche Universal Serial Bus, versione 2,0	usb.org/developers/docs

Appendice C, risorse aggiuntive

Tabella 54. Risorse aggiuntive

Risorsa	Descrizione dei contenuti	Posizione
Manuale di installazione e manutenzione	Questo manuale, disponibile in formato PDF, fornisce le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Funzionalità del telaio • Programma di configurazione del sistema • Codici degli indicatori di sistema • System BIOS (BIOS di sistema) • Rimuovere e sostituire le procedure • Diagnostica • Ponticelli e connettori 	Dell.com/Support/Manuals
Guida introduttiva	Questa guida viene fornita con il sistema ed è disponibile anche in formato PDF. Questa guida fornisce le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Procedura di installazione iniziale 	Dell.com/Support/Manuals
Guida di installazione su rack	Questo documento viene fornito con il kit rack e fornisce istruzioni per l'installazione di un server in un rack.	Dell.com/Support/Manuals
Etichetta identificativa del sistema	L'etichetta informazioni sul sistema documenta le impostazioni del layout della scheda di sistema e del ponticello di sistema. Il testo viene ridotto a icona a causa di limitazioni spaziali e considerazioni di traduzione. Le dimensioni dell'etichetta sono standardizzate su più piattaforme.	Interno del coperchio del telaio del sistema
Quick Resource Locator (QRL)	Questo codice sul telaio può essere scansionato tramite un'applicazione telefonica per accedere a ulteriori informazioni e risorse per il server, inclusi video, materiali di riferimento, informazioni sui codici di matricola e informazioni di contatto Dell EMC.	Interno del coperchio del telaio del sistema
Energy Smart Solution Advisor (ESSA)	L'ESSA online di Dell EMC offre stime più semplici e più significative che consentono di determinare la configurazione più efficiente possibile. Utilizzare ESSA per calcolare il consumo energetico dell'hardware, dell'infrastruttura di alimentazione e dello storage.	Dell.com/calc